

2024年03月25日



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

铜缆互联成为英伟达 GTC 大会亮点，头部厂商纷纷布局 AI PC

—电子行业周报

推荐(维持)

投资要点

分析师：毛正 S1050521120001

maozheng@cfsc.com.cn

分析师：吕卓阳 S1050523060001

lvzy@cfsc.com.cn

联系人：何鹏程 S1050123080008

hepc@cfsc.com.cn

行业相对表现

表现	1M	3M	12M
电子(申万)	23.3	-10.5	-12.0
沪深300	11.3	1.6	-14.4

市场表现



资料来源：Wind，华鑫证券研究

相关研究

- 《电子行业周报：英伟达 GTC 大会临近，关注相关投资机遇》2024-03-19
- 《电子行业专题报告：行至功率周期底部，静待下游复苏云起》2024-03-15
- 《电子行业周报：存储市场重回上行轨道，国家大基金三期或将推出》2024-03-11

上周回顾

3月18日-22日当周，申万一级行业大部分处于下跌状态。其中电子行业下跌0.96%，位列第12位。估值前三的行业为计算机、农林牧渔、国防军工，电子行业市盈率为44.79，位列第6位。

电子行业细分板大多处于下降态势，其中半导体设备领涨，涨幅为4.15%。估值方面，LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平位列前三，数字芯片设计、半导体材料估值排名本周第四、五位。

英伟达 GTC 大会如期举行，铜缆互联成为大亮点

近日举行的英伟达全球技术大会（GTC）备受瞩目，英伟达推出新 Blackwell 架构 GPU 组成的 GB200，将提供4倍于 Hopper 的训练性能，大模型参数达到了万亿级别。此外，GB200 芯片采用铜缆连接成一大亮点。英伟达 GB200 NVLink Switch 和 Spine 由72个 Blackwell GPU 采用 NVLink 全互连，具有5000根 NVLink 铜缆，合计长度超2英里。

建议关注产业链相关公司：兆龙互联、新亚电子、华丰科技、沃尔核材以及鼎通科技等。

头部厂商纷纷布局 AI PC，产业链迎来发展大机遇

AMD 近期在北京举办 AI PC 创新峰会，携手产业链合作伙伴，展示了其在中国 AI PC 生态系统中的发展势头，并将领先的 AI 计算带给消费者。此外，微软于3月21日晚间举办主题为“办公新时代”的线上新品发布会，发布 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6，新品将搭载基于英特尔酷睿 Ultra 或高通骁龙 X Elite 的处理器，配备新一代 NPU，以增强 AI 性能。苹果本月也发布新款 MacBook Air，搭载 M3 芯片，称新款 MacBook Air 为全球最佳的 AI 消费级笔记本电脑。Canalys 预测到2027年，AI PC 全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%，2023-2027年 AI PC 出货量 CAGR 达63%。

建议关注 AI PC 产业链标的：芯海科技、聚辰股份、春秋电子、光大同创、雷神科技以及翰博高新等。

风险提示

半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2024-03-25 股价	EPS			PE			投资评级
			2022	2023E	2024E	2022	2023E	2024E	
002130.SZ	沃尔核材	10.77	0.49	0.56	0.69	13.22	13.41	15.64	未评级
300913.SZ	兆龙互连	42.82	0.71	0.43	0.62	22.89	99.24	69.12	未评级
301321.SZ	翰博高新	15.13	-0.44	0.37	0.86	-42.76	40.73	17.69	未评级
301387.SZ	光大同创	50.90	1.99	2.15	3.00	25.58	23.67	16.97	买入
603890.SH	春秋电子	9.51	0.36	0.13	0.48	25.52	75.91	19.92	买入
688123.SH	聚辰股份	55.48	2.93	0.61	2.09	18.94	90.95	26.55	买入
688595.SH	芯海科技	31.87	0.02	-1.01	0.16	2045.85	-43.06	193.48	未评级
688629.SH	华丰科技	28.19	0.25	0.16	0.33		139.04	84.52	未评级
688668.SH	鼎通科技	64.66	1.70	0.71	2.22	38.72	77.69	29.11	未评级
872190.BJ	雷神科技	18.78	1.10	0.58	0.76	17.07	32.38	24.71	增持

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

正文目录

1、 股票组合及其变化.....	5
1.1、 本周重点推荐及推荐组	5
1.2、 海外龙头一览	6
2、 周度行情分析及展望.....	8
2.1、 周涨幅排行	8
2.2、 行业重点公司估值水平和盈利预测	10
3、 行业高频数据.....	13
3.1、 台湾电子行业指数跟踪	13
3.2、 电子行业主要产品指数跟踪	16
4、 近期新股.....	20
4.1、 广合科技(001389.SZ)：专注印制电路板供应商	20
4.2、 灿芯股份(688691.SH)：一站式芯片定制服务供应商	22
5、 行业动态跟踪.....	23
5.1、 半导体	23
5.2、 消费电子	26
5.3、 汽车电子	28
6、 行业重点公司公告.....	31
7、 风险提示.....	37

图表目录

图表 1：重点关注公司及盈利预测	5
图表 2：海外龙头估值水平及周涨幅	6
图表 3：费城半导体指数近两周走势	7
图表 4：费城半导体指数近两年走势	7
图表 5：3月18日-3月22日行业周涨跌幅比较(%)	8
图表 6：3月22日行业市盈率(TTM)比较.....	8
图表 7：3月18日-3月22日电子细分板块周涨跌幅比较(%)	8
图表 8：3月22日电子细分板块市盈率(TTM)比较.....	9
图表 9：重点公司周涨幅前十股票	10
图表 10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测	10
图表 11：台湾半导体行业指数近两周走势	13
图表 12：台湾半导体行业指数近两年走势	13
图表 13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势	13
图表 14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势	13

图表 15: 台湾电子零组件行业指数近两周走势	14
图表 16: 台湾电子零组件行业指数近两年走势	14
图表 17: 台湾光电行业指数近两周走势	14
图表 18: 台湾光电行业指数近两年走势	14
图表 19: 中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%)	15
图表 20: NAND 价格 (单位: 美元)	16
图表 21: DRAM 价格 (单位: 美元)	16
图表 22: 全球半导体销售额 (单位: 十亿美元)	16
图表 23: 全球分地区半导体销售额 (单位: 十亿美元)	16
图表 24: 面板价格 (单位: 美元/片)	17
图表 25: 国内手机月度出货量 (单位: 万部, %)	17
图表 26: 全球手机季度出货量 (单位: 百万部, %)	17
图表 27: 无线耳机月度出口量 (单位: 个, %)	18
图表 28: 无线耳机累计出口量 (单位: 个, %)	18
图表 29: 中国智能手表月度产量 (单位: 万个, %)	18
图表 30: 中国智能手表累计产量 (单位: 个, %)	18
图表 31: 全球 PC 季度出货量 (单位: 千台, %)	19
图表 32: 中国台机/服务器月度出货量 (单位: 万台)	19
图表 33: 中国新能源车月度销售量 (单位: 辆, %)	19
图表 34: 中国新能源车累计销售量 (单位: 辆, %)	19
图表 35: 广合科技产品应用情况	20
图表 36: 广合科技营业收入 (亿元)	21
图表 37: 广合科技归母净利润 (亿元)	21
图表 38: 灿芯股份产品应用情况	22
图表 39: 灿芯股份营业收入 (亿元)	23
图表 40: 灿芯股份归母净利润 (亿元)	23
图表 41: 本周重点公司公告	31

1、股票组合及其变化

1.1、本周重点推荐及推荐组

(1) 英伟达 GTC 大会如期举行，铜缆互联成为大亮点

近日举行的英伟达全球技术大会（GTC）备受瞩目，英伟达推出新 Blackwell 架构 GPU 组成的 GB200，将提供 4 倍于 Hopper 的训练性能，大模型参数达到了万亿级别。此外，GB200 芯片采用铜缆连接成一大亮点。英伟达 GB200 NVLink Switch 和 Spine 由 72 个 Blackwell GPU 采用 NVLink 全互连，具有 5000 根 NVLink 铜缆，合计长度超 2 英里。

建议关注产业链相关公司：兆龙互联、新亚电子、华丰科技、沃尔核材以及鼎通科技等。

(2) 头部厂商纷纷布局 AI PC，产业链迎来发展大机遇

AMD 近期在北京举办 AI PC 创新峰会，携手产业链合作伙伴，展示了其在中国 AI PC 生态系统中的发展势头，并将领先的 AI 计算带给消费者。此外，微软于 3 月 21 日晚间举办主题为“办公新时代”的线上新品发布会，发布 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6，新品将搭载基于英特尔酷睿 Ultra 或高通骁龙 X Elite 的处理器，配备新一代 NPU，以增强 AI 性能。苹果本月也发布新款 MacBook Air，搭载 M3 芯片，称新款 MacBook Air 为全球最佳的 AI 消费级笔记本电脑。Canalys 预测到 2027 年，AI PC 全球出货量预计超过 1.7 亿台，在总个人电脑出货量的占比超 60%，2023-2027 年 AI PC 出货量 CAGR 达 63%。

建议关注 AI PC 产业链标的：芯海科技、聚辰股份、春秋电子、光大同创、雷神科技以及翰博高新等。

图表 1：重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2024-03-25			EPS			PE			投资评级
		股价	2022	2023E	2024E	2022	2023E	2024E			
002130.SZ	沃尔核材	10.77	0.49	0.56	0.69	13.22	13.41	15.64	未评级		
300913.SZ	兆龙互连	42.82	0.71	0.43	0.62	22.89	99.24	69.12	未评级		
301321.SZ	翰博高新	15.13	-0.44	0.37	0.86	-42.76	40.73	17.69	未评级		
301387.SZ	光大同创	50.90	1.99	2.15	3.00	25.58	23.67	16.97	买入		
603890.SH	春秋电子	9.51	0.36	0.13	0.48	25.52	75.91	19.92	买入		
688123.SH	聚辰股份	55.48	2.93	0.61	2.09	18.94	90.95	26.55	买入		
688595.SH	芯海科技	31.87	0.02	-1.01	0.16	2045.85	-43.06	193.48	未评级		
688629.SH	华丰科技	28.19	0.25	0.16	0.33		139.04	84.52	未评级		
688668.SH	鼎通科技	64.66	1.70	0.71	2.22	38.72	77.69	29.11	未评级		
872190.BJ	雷神科技	18.78	1.10	0.58	0.76	17.07	32.38	24.71	增持		

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

1.2、海外龙头一览

3月18日-3月22日当周，海外龙头大部分处于上涨态势。美光科技、博通、拉姆研究领涨，涨幅分别为18.19%、10.01%、7.45%；超威半导体领跌，跌幅为5.97%。

图表 2：海外龙头估值水平及周涨幅

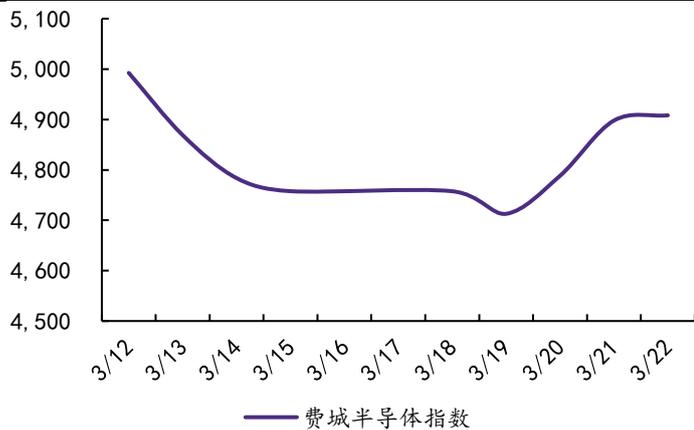
	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元) 2024-03-22	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)
处理器	INTC.O	英特尔	美国	1800	107	2	-0.16
	QCOM.O	高通	美国	1898	26	8	1.73
	AMD.O	超威半导体	美国	2903	340	5	-5.97
	NVDA.O	英伟达	美国	23572	79	55	7.35
存储	MU.O	美光科技	美国	1220	-21	3	18.19
模拟	TXN.O	德州仪器	美国	1568	24	9	-0.02
	ADI.O	亚德诺	美国	960	29	3	-0.87
	AVGO.O	博通	美国	6272	45	9	10.01
	NXPI.O	恩智浦半导体	荷兰	627	22	7	3.30
射频	SWKS.O	思佳讯	美国	169	17	3	1.44
	QRVO.O	QORVO	美国	110	107	3	2.26
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	391	9	2	-3.33
	ON.O	安森美半导体	美国	319	15	4	-0.25
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	408	13	2	-2.18
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	3263	18	2	-1.25
半导体设备	AMAT.O	应用材料	美国	1747	25	10	5.84
	LRCX.O	拉姆研究	美国	1282	28	16	7.45
	KLAC.O	科天半导体	美国	961	28	32	3.90
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	3867	44	26	4.23
	硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2589	17	4
光刻胶	4185.T	JSR	日本	9020	57	2	0.30
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	228988	24	6	4.67
	GFS.O	GLOBALFOUNDRIES	开曼群岛	289	28	3	0.64
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	651	-817	2	5.50
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	245	24	3	3.89
分销	ARW.N	艾睿电子	美国	66	7	1	1.53
	AVT.O	安富利	美国	43	6	1	1.70

资料来源：wind，华鑫证券研究，截至2024年3月22日收盘价

从更宏观角度，我们可以用费城半导体指数来观察海外半导体行业整体情况。该指数涵盖了 17 家 IC 设计商、6 家半导体设备商、1 家半导体制造商和 6 家 IDM 商，且大部分以美国厂商为主，能较好代表海外半导体产业情况。

从数据来看，3 月 18 日-3 月 22 日当周，费城半导体指数呈现增长态势，近两周处于先降后升的态势。更长时间维度上来看，指数在进入 2022 年下行通道后，2023 年 1-6 月，复苏迹象明显，处于震荡上行行情；7 月以来处于下行行情；10 月底开始持续上涨。

图表 3：费城半导体指数近两周走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 4：费城半导体指数近两年走势



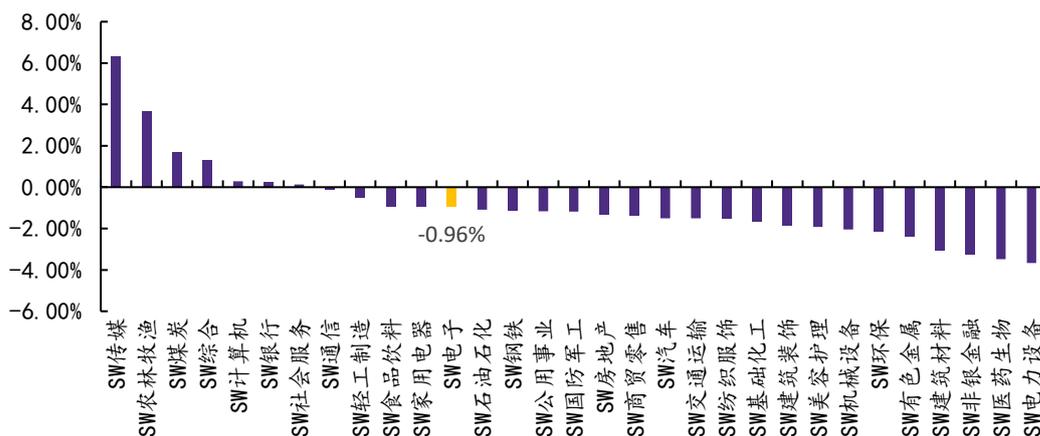
资料来源：wind，华鑫证券研究

2、周度行情分析及展望

2.1、周涨幅排行

跨行业比较，3月18日-22日当周，申万一级行业大部分处于下跌状态。其中电子行业下跌0.96%，位列第12位。估值前三的行业为计算机、农林牧渔、国防军工，电子行业市盈率为44.79，位列第6位。

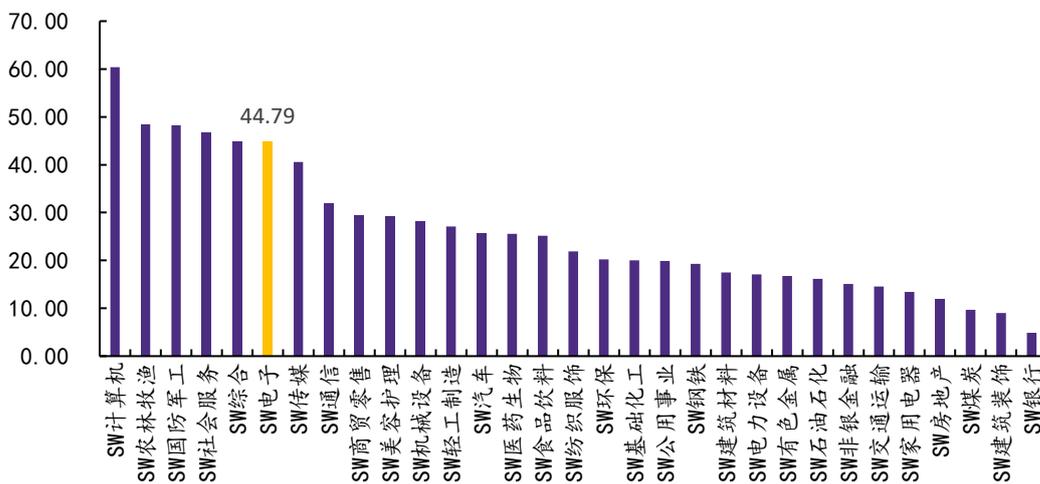
图表5：3月18日-3月22日行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

注：按申万行业一级分类

图表6：3月22日行业市盈率（TTM）比较

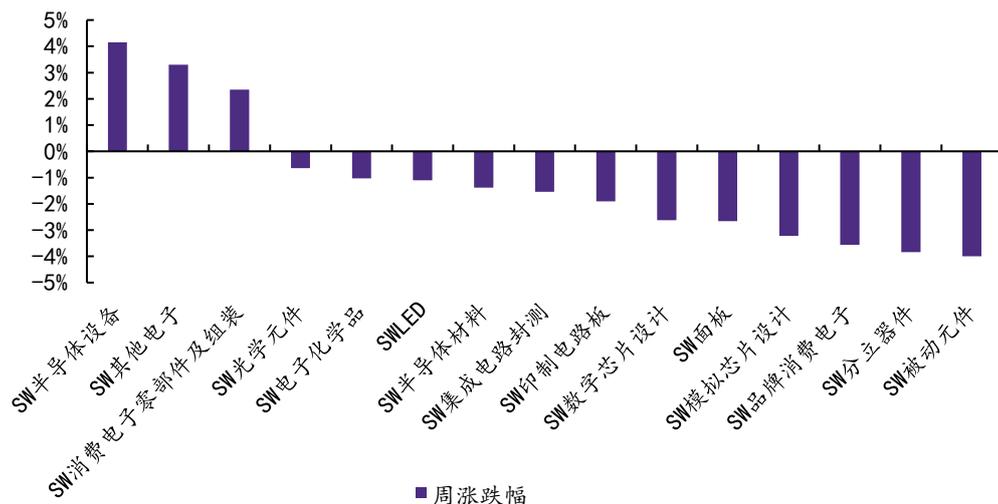


资料来源：wind，华鑫证券研究

注：按申万行业一级分类

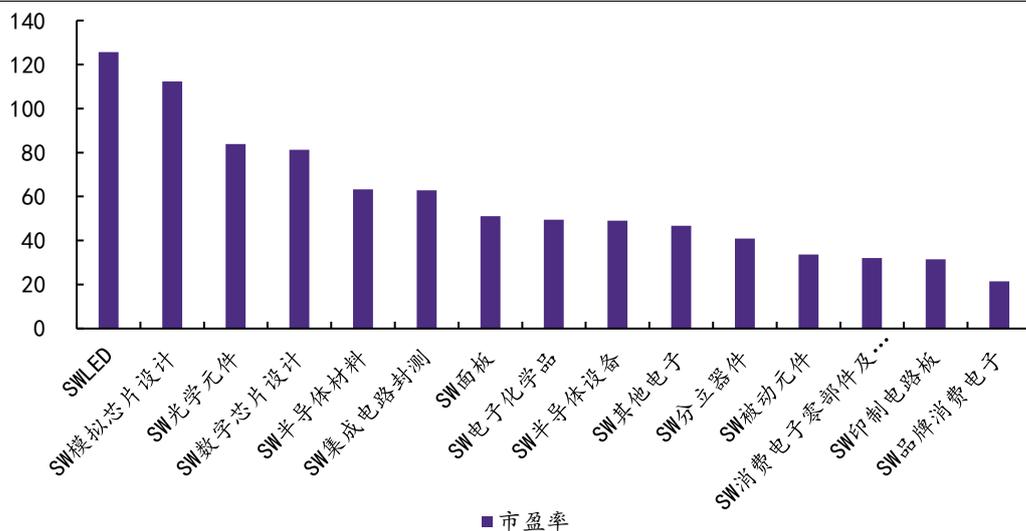
电子行业细分板块比较，3月18日-3月22日当周，电子行业细分板大多处于下降态势，其中半导体设备领涨，涨幅为4.15%。估值方面，LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平位列前三，数字芯片设计、半导体材料估值排名本周第四、五位。

图表7：3月18日-3月22日电子细分板块周涨跌幅比较（%）



资料来源: wind, 华鑫证券研究
注: 按申万行业三级分类

图表 8: 3月22日电子细分板块市盈率(TTM)比较



资料来源: wind, 华鑫证券研究
注: 按申万行业三级分类

3月18日-3月22日当周，重点关注公司周涨幅前十：消费电子零部件、电子化学品、数字IC、封测、被动元器件、仪器仪表、PCB、通信工程及服务、光学元件、其他专用设备及品牌分销各占一席。和林微纳（消费电子）、思泉新材（电子化学品）、爱施德（平拍分销）包揽前三，周涨幅分别为19.58%、19.26%、17.94%。

图表9：重点公司周涨幅前十股票

分类	证券代码	证券简称	市值 (亿元) 2024-03-22	ROE (%)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)	投资评级
					2022	2023E	2024E	2022	2023E	2024E			
消费电子零部件及组装	688661.SH	和林微纳	41.50	7.90	0.42	0.54	1.92	109	85	24	3.39	19.58	买入
电子化学品	301489.SZ	思泉新材	51.11	11.15	1.35	1.44	1.89	87	62	47	11.44	19.26	增持
品牌分销	002416.SZ	爱施德	151.56	11.64	0.59	0.79	0.93	19	15	13	2.60	17.94	买入
封测	688372.SH	伟测科技	77.04	8.64	2.79	3.95	5.66	32	22	16	3.13	16.79	未评级
被动元件	301099.SZ	雅创电子	35.36	6.90	1.93	0.81	1.99	22	54	22	3.54	14.21	增持
其他专用设备	688630.SH	芯碁微装	98.00	15.04	1.13	1.43	2.15	72	52	35	4.99	9.53	增持
仪器仪表	300567.SZ	精测电子	207.28	5.80	0.98	1.15	1.51	100	65	49	6.42	8.71	买入
数字IC	301308.SZ	江波龙	399.20	-12.61	0.18	0.24	0.72	548	399	134	6.74	7.31	增持
PCB	300903.SZ	科翔股份	34.09	0.00	0.12	0.30	0.57	73	27	15	1.48	7.31	买入
光学元件	002456.SZ	欧菲光	340.12	-0.10	-1.59	0.00	0.29	-6	-17006	36	11.37	6.64	增持

资料来源：wind，华鑫证券研究，截至2024年3月22日收盘价

2.2、行业重点公司估值水平和盈利预测

图表10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测

分类	证券代码	证券简称	市值 (亿元) 2024-03-22	ROE (%)	EPS			PE			PB	投资评级
					2022	2023E	2024E	2022	2023E	2024E		
Chiplet	300493.SZ	润欣科技	39.76	4.10	0.11	0.21	0.31	74	37	25	3.71	买入
EDA	688206.SH	概伦电子	72.27	1.76	0.10	0.11	0.18	166	147	93	3.42	买入
LED	002449.SZ	国星光电	46.45	4.20	0.20	0.34	0.41	38	22	18	1.22	增持
	600363.SH	联创光电	138.89	10.82	0.59	0.99	1.33	42	31	23	3.50	买入
LED&SiC	600703.SH	三安光电	646.08	0.87	0.14	0.06	0.23	94	213	57	1.68	买入
LED设备	688383.SH	新益昌	75.91	15.30	2.00	3.27	4.20	37	23	18	5.50	买入
	002436.SZ	兴森科技	229.45	3.86	0.31	0.14	0.28	47	100	48	3.45	增持
PCB	300903.SZ	科翔股份	34.09		0.12	0.30	0.57	73	27	15	1.48	买入
	603920.SH	世运电路	101.12	15.28	0.82	0.94	1.13	25	20	17	3.42	买入
	688020.SH	方邦股份	26.42	3.78	-0.85	-0.65	0.64	-41	-51	51	1.76	买入
半导体材料	605358.SH	立昂微	158.93	2.75	1.02	0.60	0.93	24	39	25	2.02	买入
	688126.SH	沪硅产业	385.43	2.05	0.12	0.11	0.16	112	126	90	2.60	增持
	688234.SH	天岳先进	223.36	2.28	-0.41	-0.10	0.26	-127	-508	199	4.31	买入
半导体设备	300812.SZ	易天股份	41.98	5.35	0.32	0.34	0.50	98	89	60	4.66	买入
	688012.SH	中微公司	983.48	10.46	1.90	2.87	3.02	84	55	53	5.52	买入
被动元件	000636.SZ	风华高科	144.16	2.22	0.28	0.54	0.76	42	23	16	1.21	买入
	002138.SZ	顺络电子	219.00	13.57	0.54	0.84	1.14	42	32	24	3.67	买入
	301099.SZ	雅创电子	35.36	6.90	1.93	0.81	1.99	22	54	22	3.54	增持

	603738.SH	泰晶科技	56.41	5.67	0.68	0.27	0.51	30	54	28	3.26	未评级
磁性材料	600366.SH	宁波韵升	72.15	-2.80	0.32	-0.15	0.39	20	-44	16	1.24	未评级
	300054.SZ	鼎龙股份	209.95	5.93	0.41	0.28	0.47	46	80	47	4.73	未评级
	300655.SZ	晶瑞电材	84.02	1.68	0.28	0.32	0.43	50	44	34	4.51	买入
电子化学品	301489.SZ	思泉新材	51.11	11.15	1.35	1.44	1.89	87	62	47	11.44	增持
	688106.SH	金宏气体	97.68	12.38	0.47	0.64	0.77	41	32	26	3.28	买入
	688268.SH	华特气体	61.46	12.99	1.71	1.54	2.19	30	33	23	3.75	买入
	688371.SH	菲沃泰	42.50	5.70	0.10	-0.31	0.36	128	-152	35	2.13	未评级
	002156.SZ	通富微电	376.07	1.39	0.33	0.11	0.59	71	231	42	2.74	增持
	600584.SH	长电科技	505.34	5.91	1.82	0.83	1.32	16	34	21	1.96	买入
封测	688362.SH	甬矽电子	91.81	6.72	0.34	0.40	0.69	67	56	33	3.80	买入
	688372.SH	伟测科技	77.04	8.64	2.79	1.52	1.99	32	76	34	3.13	未评级
	688403.SH	汇成股份	73.47	8.10	0.21	0.22	0.28	41	40	32	2.39	增持
	300623.SZ	捷捷微电	113.84	7.85	0.49	0.31	0.41	32	50	38	3.30	买入
	600460.SH	士兰微	349.62	-1.01	0.74	0.45	0.71	33	55	35	4.91	买入
功率半导体	605111.SH	新洁能	112.33	8.19	2.04	1.07	1.41	26	35	27	3.15	买入
	688261.SH	东微半导	61.12	7.80	4.22	5.76	7.67	21	16	12	2.13	买入
	688711.SH	宏微科技	49.00	18.69	0.57	0.99	1.70	62	33	19	4.54	买入
光刻胶	603306.SH	华懋科技	70.01	8.53	0.62	0.89	1.61	36	24	13	2.05	买入
光芯片	688498.SH	源杰科技	133.66	4.34	1.67	1.23	1.64	133	129	96	6.31	买入
	002036.SZ	联创电子	87.19	-3.72	0.09	-0.13	0.26	135	-61	31	2.54	未评级
	002222.SZ	福晶科技	124.10	16.33	0.53	0.56	0.65	52	52	44	8.62	买入
	002456.SZ	欧菲光	340.12	-0.10	-1.59	0.00	0.29	-6	-17006	36	11.37	增持
	301421.SZ	波长光电	59.97	14.00	0.71	0.52	0.75	99	100	70	5.11	增持
光学元件	603297.SH	永新光学	90.05	14.65	2.53	2.71	3.23	32	30	25	5.10	增持
	688010.SH	福光股份	31.47		0.19	0.32	0.43	124	64	48	1.80	买入
	688195.SH	腾景科技	35.78	7.71	0.45	0.62	0.88	61	44	31	3.96	买入
	688502.SH	茂莱光学	66.58	11.00	1.49	1.41	1.92	113	90	66	5.64	增持
	688167.SH	炬光科技	84.42	5.49	1.41	0.80	1.52	67	116	62	3.49	买入
环保设备III	688376.SH	美埃科技	45.90	12.39	0.92	1.26	1.73	37	27	20	2.89	增持
	002008.SZ	大族激光	204.44	6.20	1.15	0.88	1.31	16	22	15	1.27	未评级
激光设备	688025.SH	杰普特	52.49	10.73	0.82	1.46	2.23	69	38	25	2.71	买入
	688170.SH	德龙激光	32.02	4.07	0.65	-0.05	0.55	48	-534	56	2.54	增持
家电零部件	300475.SZ	香农芯创	198.08	14.66	0.75	0.73	0.87	63	59	50	7.98	增持
金属制品	873693.BJ	阿为特	21.09	10.10	0.46	0.43	0.48	75	68	60	7.84	增持
军工电子	300045.SZ	华力创通	156.19	1.74	-0.17	0.03	0.08	-142	868	284	9.05	买入
	002387.SZ	维信诺	120.47	-23.09	-1.50	-0.97	-0.28	-5	-9	-31	1.31	增持
	002876.SZ	三利谱	43.54	4.87	1.19	0.77	1.40	21	32	18	1.85	增持
面板	300088.SZ	长信科技	136.00	5.48	0.28	0.25	0.31	19	22	18	1.64	增持
	300909.SZ	汇创达	45.02	6.50	0.85	0.56	1.06	36	47	24	2.42	未评级
	603773.SH	沃格光电	50.99	-0.81	-1.89	0.53	0.89	-17	57	34	3.75	买入
	300661.SZ	圣邦股份	320.70	6.55	2.44	0.50	1.05	37	137	65	8.75	买入
	300782.SZ	卓胜微	564.83	14.70	2.00	2.36	2.91	52	45	36	5.96	买入
模拟 IC	603160.SH	汇顶科技	285.66	1.62	-1.63	0.27	1.16	-38	234	54	3.62	增持
	688052.SH	纳芯微	153.96	0.73	2.48	2.24	4.14	62	49	26	2.45	买入
	688173.SH	希荻微	58.39	3.00	-0.04	0.04	0.13	-385	389	106	3.07	买入
	688220.SH	翱捷科技-U	187.23	-5.22	-0.60	-0.94	-0.38	-74	-47	-117	2.89	买入

	688368.SH	晶丰明源	48.26	7.87	-3.27	-0.23	1.74	-23	-345	44	3.40	增持
	688458.SH	美芯晟	45.68	4.53	0.88	1.02	1.90	87	56	30	2.22	买入
	688515.SH	裕太微-U	67.52	58.02	-0.01	0.29	0.99	-16530	294	85	3.68	买入
	688798.SH	艾为电子	137.72	2.80	-0.32	0.20	1.33	-258	417	63	3.91	买入
膜材料	300806.SZ	斯迪克	45.06	6.00	0.52	0.31	0.56	27	32	18	2.01	买入
品牌分销	002416.SZ	爱施德	151.56	11.64	0.59	0.79	0.93	19	15	13	2.60	买入
品牌整机	688036.SH	传音控股	1286.63	27.42	3.09	6.81	8.18	52	23	20	6.92	买入
其他电子III	688662.SH	富信科技	23.78	8.00	0.62	0.20	0.71	42	132	38	3.47	增持
其他计算机设备	300042.SZ	朗科科技	64.81	-0.22	0.31	0.28	0.38	104	116	86	5.70	买入
	872190.BJ	雷神科技	20.55	8.10	1.10	0.58	0.76	30	35	27	2.46	增持
其他专用设备	688630.SH	芯基微装	98.00	15.04	1.13	1.43	2.15	72	52	35	4.99	增持
软件	600225.SH	卓朗科技	109.51		0.12	0.06	0.08	28	54	40	4.80	买入
	300223.SZ	北京君正	332.91	4.59	1.64	1.81	2.36	43	38	29	2.87	买入
	300458.SZ	全志科技	127.93	5.70	0.34	0.03	0.27	61	673	74	4.42	增持
	301308.SZ	江波龙	399.20	-12.61	0.18	0.24	0.72	548	399	134	6.74	增持
	603501.SH	韦尔股份	1200.58	5.25	0.84	0.90	2.26	125	113	45	6.73	买入
	603893.SH	瑞芯微	225.52	5.63	0.71	0.33	0.86	76	162	62	7.63	买入
	603986.SH	兆易创新	522.72	3.32	3.08	1.27	2.37	25	62	33	3.36	买入
	688018.SH	乐鑫科技	77.44	8.99	1.21	1.88	2.38	80	51	40	4.01	买入
	688099.SH	晶晨股份	226.11	13.75	1.76	1.99	2.69	31	27	20	4.14	买入
	688110.SH	东芯股份	119.63	3.38	0.42	0.51	0.80	55	53	34	3.23	买入
数字 IC	688123.SH	聚辰股份	92.72	14.91	2.93	0.61	2.09	27	97	28	4.79	买入
	688213.SH	思特威-W	212.97	6.66	-0.21	0.64	1.01	-257	83	52	5.78	买入
	688259.SH	创耀科技	46.09	6.31	1.14	1.41	1.89	51	41	31	3.07	增持
	688262.SH	国芯科技	77.25	4.30	0.32	1.06	1.71	100	30	19	3.01	增持
	688332.SH	中科蓝讯	77.52	8.27	1.17	1.95	2.66	55	33	24	2.09	买入
	688385.SH	复旦微电	218.79	17.98	1.32	1.84	2.19	20	15	12	5.58	买入
	688486.SH	龙迅股份	63.74	14.17	1.33	1.33	1.77	92	69	52	4.56	增持
	688521.SH	芯原股份	198.36	1.74	0.15	-0.09	0.06	269	-422	684	6.87	增持
	688608.SH	恒玄科技	132.33	4.80	1.02	2.25	2.85	108	49	39	2.17	买入
	688728.SH	格科微	462.38	3.73	0.18	0.08	0.14	105	220	123	5.82	增持
	688766.SH	普冉股份	73.63	5.93	1.64	-0.68	1.11	89	-144	88	3.92	买入
通信工程及服务	603220.SH	中贝通信	120.92	11.60	0.32	0.57	0.66	109	63	54	6.66	买入
通信网络设备及器件	300308.SZ	中际旭创	1346.18	24.02	1.53	2.72	5.01	109	62	33	9.92	增持
	300394.SZ	天孚通信	637.58	28.69	1.02	1.82	2.87	157	89	56	22.06	买入
通信线缆及配套	600487.SH	亨通光电	324.62	8.24	0.64	0.87	1.09	20	15	12	1.31	增持
通信终端及配件	832149.BJ	利尔达	21.71	10.55	0.28	0.26	0.33	19	20	16	2.76	增持
	002241.SZ	歌尔股份	601.42	4.56	0.51	0.41	0.67	34	43	26	1.96	未评级
	002993.SZ	奥海科技	93.27	9.98	1.59	2.14	2.85	21	16	12	1.96	买入
	300115.SZ	长盈精密	129.30	9.61	0.04	0.12	0.50	189	90	21	2.23	增持
消费电子零部件及组装	300136.SZ	信维通信	203.19	10.34	0.67	0.84	1.10	31	25	19	2.88	买入
	300684.SZ	中石科技	53.37	7.81	0.69	0.71	0.83	28	25	21	2.85	买入
	300709.SZ	精研科技	65.57	10.71	-1.25	1.11	1.53	-25	32	23	3.23	增持
	300793.SZ	佳禾智能	53.63	7.00	0.51	0.53	0.64	31	30	25	2.11	未评级
	600745.SH	闻泰科技	474.38	7.54	1.17	2.32	3.03	35	16	13	1.30	未评级

	601231.SH	环旭电子	320.92	14.37	1.39	0.88	1.18	10	17	12	2.02	未评级
	603296.SH	华勤技术	545.80	14.61	3.93	3.51	3.98	22	21	19	2.72	买入
	603380.SH	易德龙	32.48	11.54	1.11	1.00	1.39	18	20	15	2.45	未评级
	688661.SH	和林微纳	41.50	7.90	0.42	0.54	1.92	109	85	24	3.39	买入
	688283.SH	坤恒顺维	34.90	12.64	0.97	1.48	1.68	43	66	25	3.74	未评级
	300354.SZ	东华测试	61.83	23.37	0.88	1.24	1.95	51	36	23	9.29	买入
仪器仪表	300567.SZ	精测电子	207.28	5.80	0.98	1.15	1.51	100	65	49	6.42	买入
	688112.SH	鼎阳科技	58.71	11.85	1.32	1.16	1.66	42	32	22	3.84	买入
	688337.SH	普源精电	68.00	6.12	0.76	0.97	1.42	74	39	27	2.35	买入
	688628.SH	优利德	46.00	16.84	1.06	1.68	2.33	40	25	18	3.96	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究，截至 2024 年 3 月 22 日收盘价

3、行业高频数据

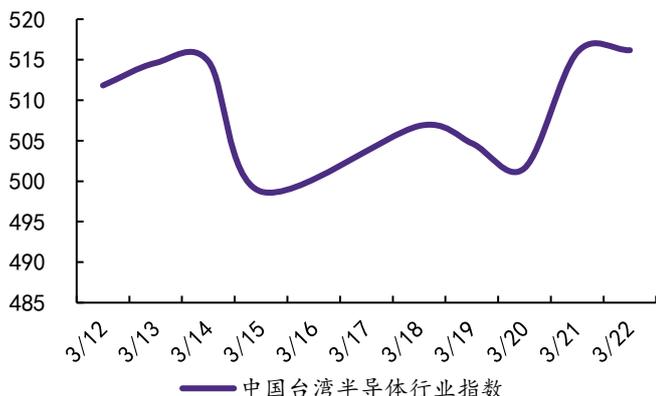
3.1、台湾电子行业指数跟踪

行业指标上，我们依次选取台湾半导体行业指数、台湾计算机及外围设备行业指数、台湾电子零部件行业指数、台湾光电行业指数，来观察行业整体景气。日期上，我们分别截取各指数近两周的日度数据、近两年的周度数据，来考察不同时间维度的变化。

近两周：环比看，3 月 18 日-3 月 22 日两周，台湾半导体行业指数呈现波动态势；台湾计算机及外围设备行业指数、台湾电子零部件行业指数以及台湾光电行业指数呈现先降后升的态势。

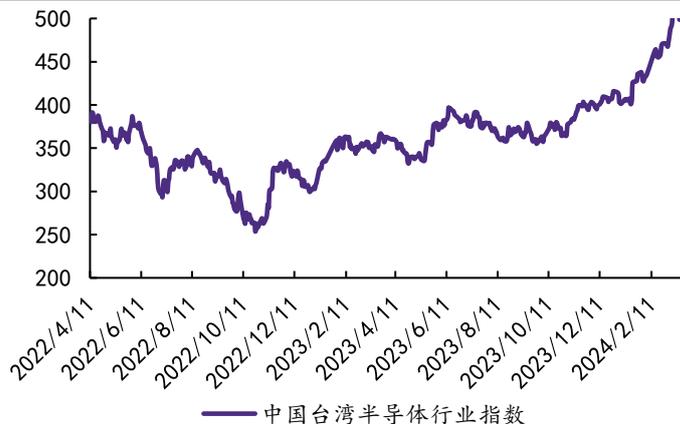
近两年：更长时间维度看，台湾电子行业各细分板块指数经过 2022 年震荡下行后，上半年整体呈现震荡上行趋势，但进入下半年以来复苏放缓。其中台湾计算机及外围设备行业指数 2023 年 7 月以来呈现先降后升态势，台湾电子零部件行业指数、台湾半导体行业指数近期有所回升，台湾光电行业指数则在低位震荡。

图表 11：台湾半导体行业指数近两周走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

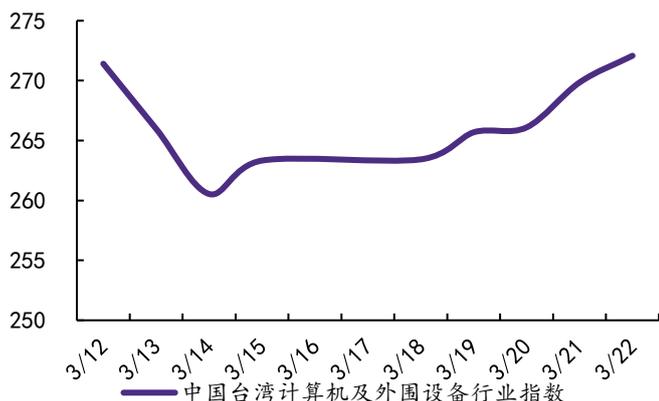
图表 12：台湾半导体行业指数近两年走势



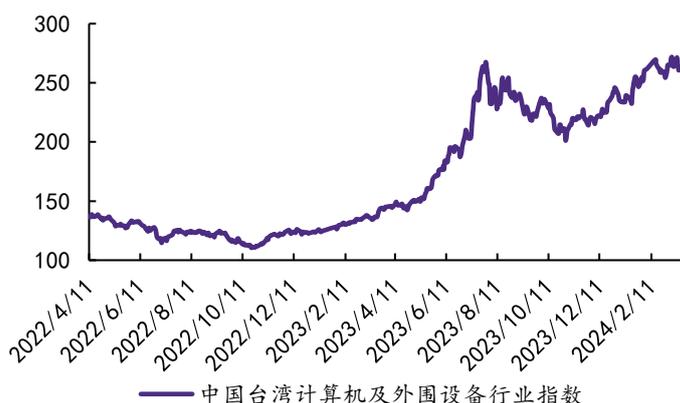
资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势

图表 14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势

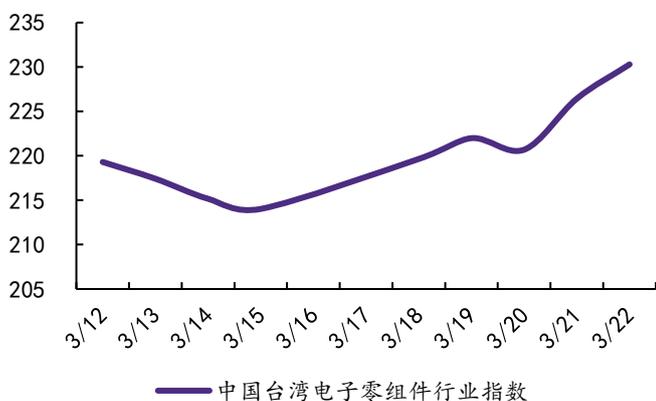


资料来源: wind, 华鑫证券研究



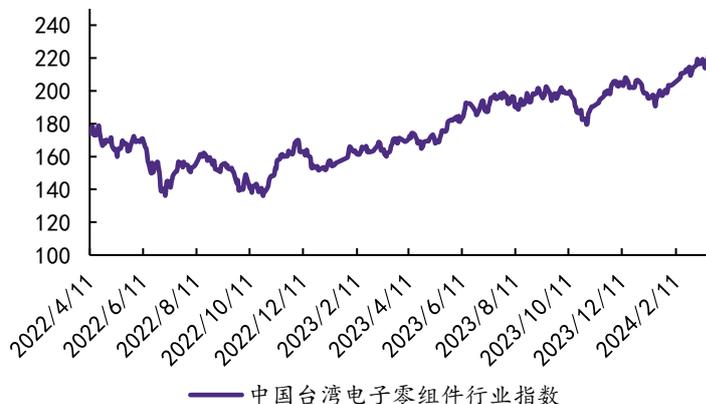
资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 15: 台湾电子零部件行业指数近两周走势



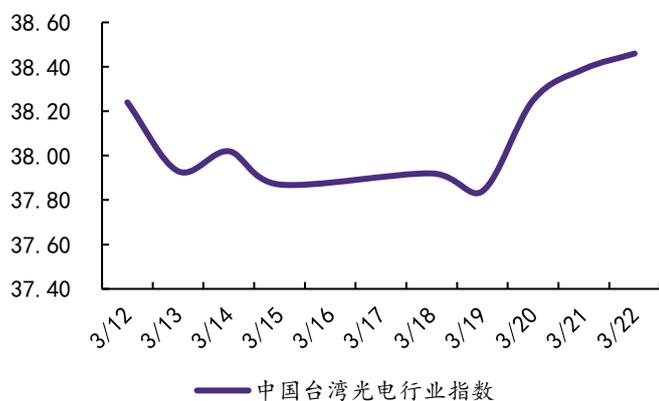
资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 16: 台湾电子零部件行业指数近两年走势



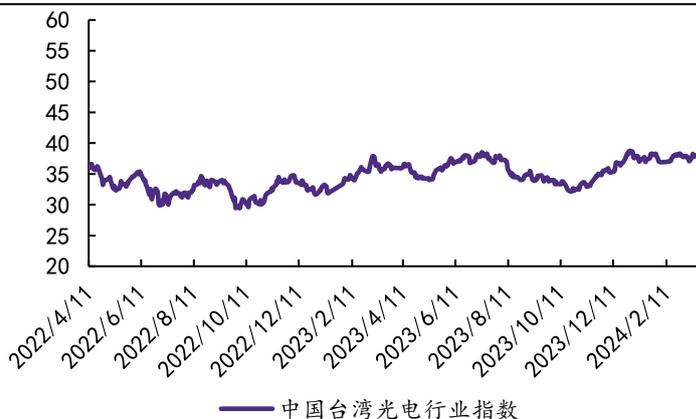
资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 17: 台湾光电行业指数近两周走势



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 18: 台湾光电行业指数近两年走势

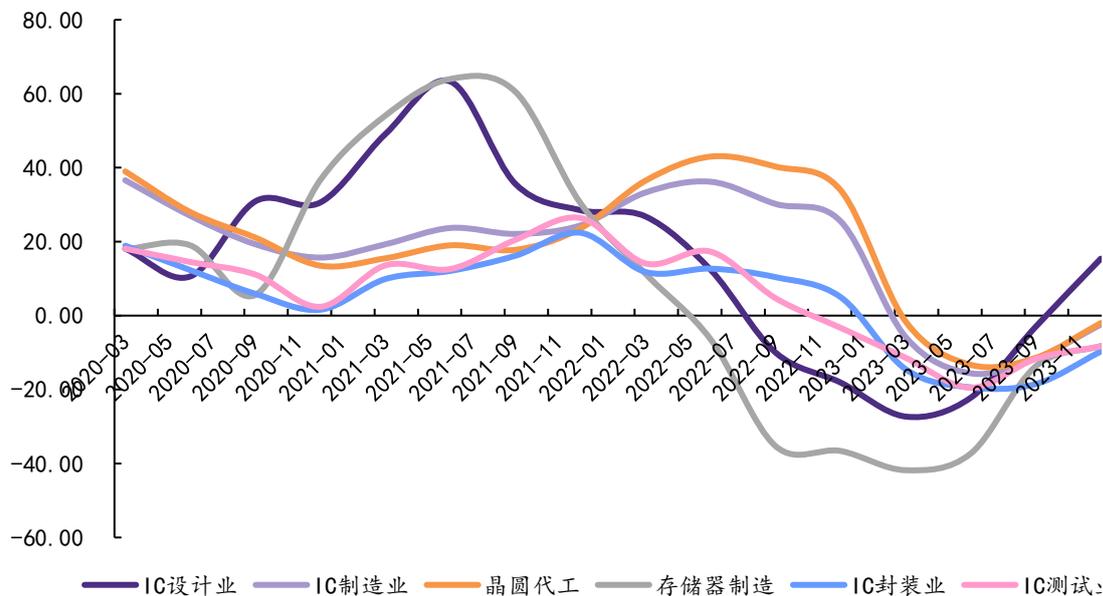


资料来源: wind, 华鑫证券研究

我们可以通过中国台湾 IC 产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾 IC 各板块产值同比增速自 2021 年以来持续下降，从 2023 年 Q2 开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC 板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致 IC 设计下滑，加之 2021 年缺货、涨价导致的 2022 年库存水位上升。但随着 AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，预计 2024 年需求将开始回升。

图表 19：中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%)

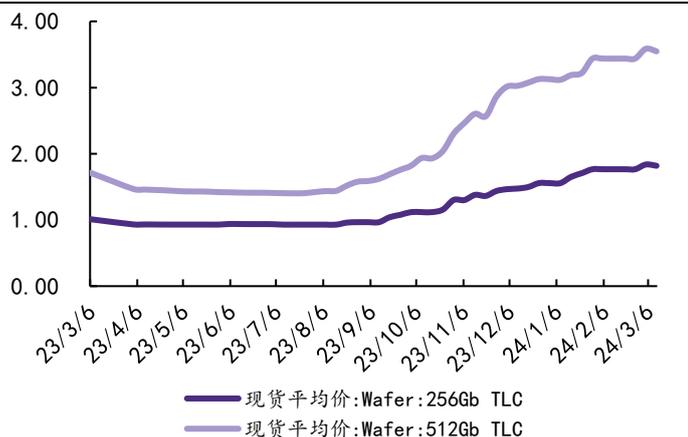


资料来源：wind，华鑫证券研究

3.2、电子行业主要产品指数跟踪

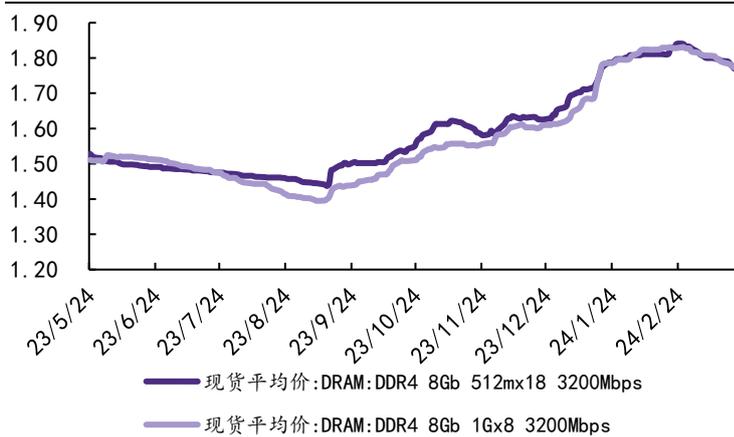
受益于上游头部供应商减产以及 Q4 消费电子市场有所恢复，存储芯片价格整体呈现回升趋势。NAND 方面：Wafer:512Gb TLC 现货平均价从 2023 年 7 月底开始回升，2024 年 3 月 11 日价格为 3.55 美元。DRAM 方面：DRAM:DDR4 8Gb 512mx18 3200Mbps 现货平均价从 2023 年 9 月中旬开始持续上涨，2024 年 3 月 22 日价格为 1.77 美元。

图表 20：NAND 价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

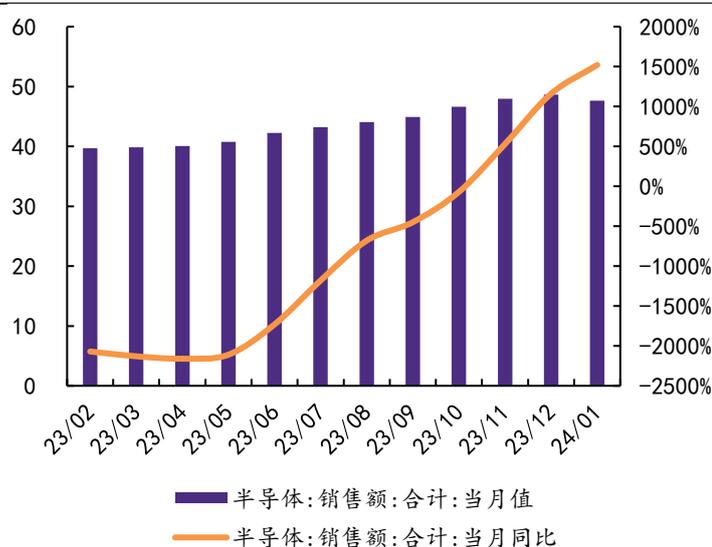
图表 21：DRAM 价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

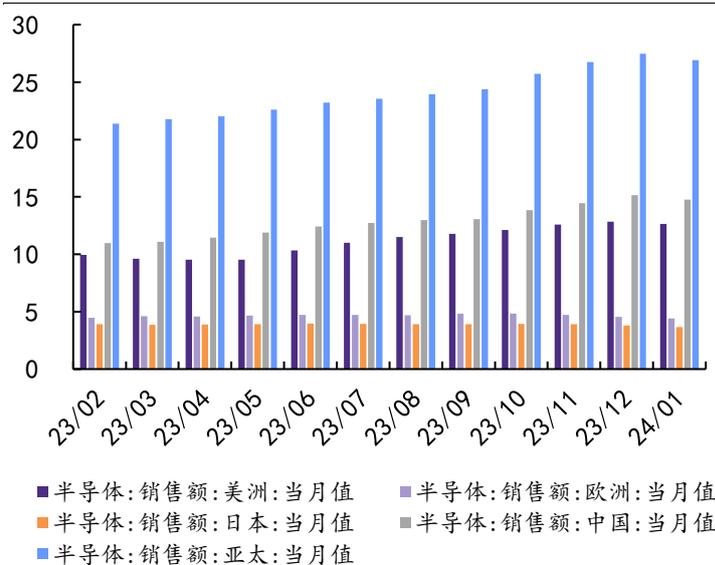
全球半导体销售额 2023 年 H1 整体呈同比下降态势。2024 年 1 月，全球半导体当月销售额为 476.3 亿美元，同比增长 15.20%，环比下降 2.12pct。其中，中国销售额为 147.6 亿美元，同比增长 26.59%，环比下降 0.12pct，占比达 30.99%。此外，从 2023 年 3 月开始全球半导体当月销售额逐月递增，自 2023 年 4 月以来，全球半导体销售额同比降幅逐月收窄；2023 年 11 月份开始全球半导体销售额同比转为增长。

图表 22：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

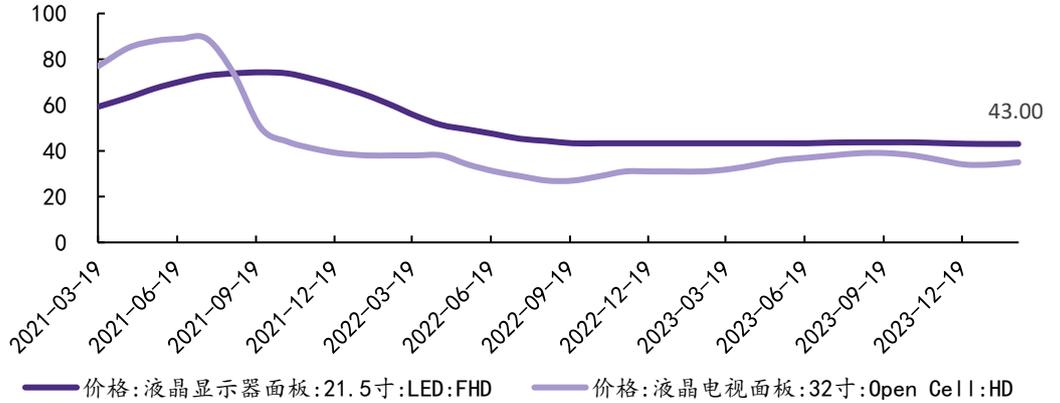
图表 23：全球分地区半导体销售额（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

面板价格保持稳定态势。面板价格自 2021 年 7 月以来，价格持续下降，目前价格整体保持稳定，其中液晶电视面板:32 寸:Open Cell:HD 价格自 2023 年 3 月 23 日后开始略有回升，近期则有所回落，2024 年 2 月 22 日为 35 美元/片，液晶显示器面板:21.5 寸:LED:FHD 价格自 2022 年 8 月 23 日以来，价格稳定在 43.3 美元/片，2024 年 2 月 22 日价格略有下降，为 43.00 美元/片。

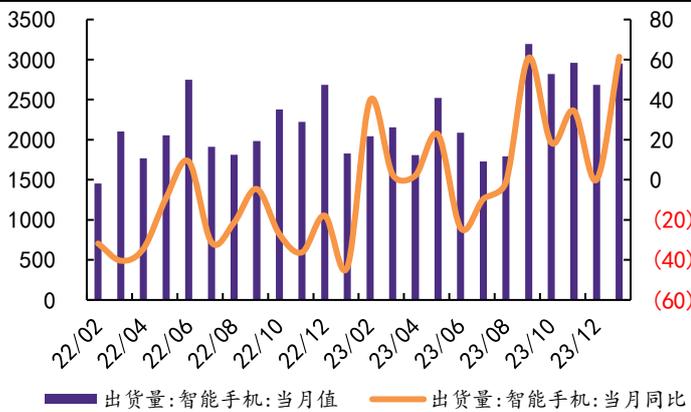
图表 24: 面板价格 (单位: 美元/片)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

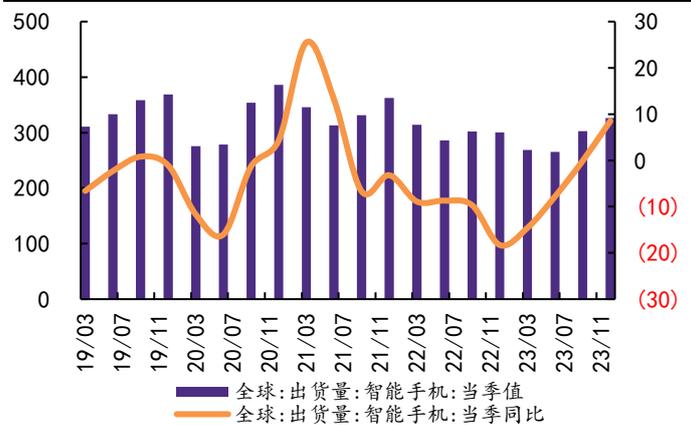
自 2023 年 Q4 以来,手机出货量同比提升显著。2023 年 9 月同比大增 60.90%, 10 月同比增长 18.50%, 11 月同比增长 34.40%, 12 月同比持平; 全球智能手机出货量同比降幅逐季收窄, 2023 年 12 月同比增幅转正; 2024 年 1 月, 国内智能手机出货量大幅提升, 同比增长 61.40%。其主要原因系库存调整接近尾声, 新兴市场的终端用户需求持续改善。随着 AI 技术的加持, 我们预计 2024 年智能手机市场将进一步修复。

图表 25: 国内手机月度出货量 (单位: 万部, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 26: 全球手机季度出货量 (单位: 百万部, %)

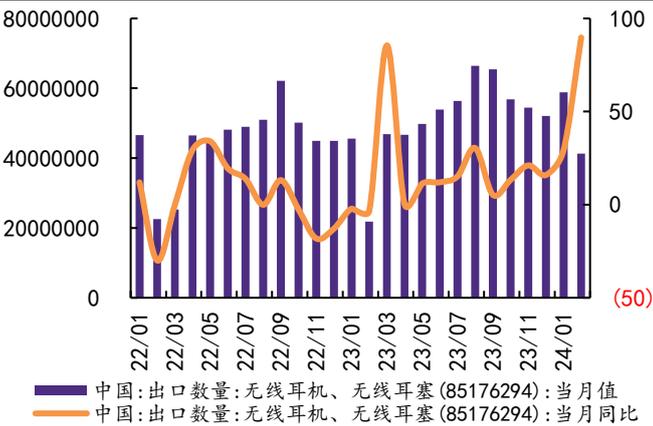


资料来源: wind, 华鑫证券研究

无线耳机方面，国内海关出口数据显示，2023 年以来呈现复苏趋势。2023 年一季度累计值为 1.14 亿个，同比增长 21.01%，二季度累计出口量为 1.50 亿个，同比增长 7.89%，环比增长 31.62%；三季度累计出口量为 1.88 亿个，同比增长 16.18%，环比增长 25.24%；四季度累计出口量为 1.63 亿个，同比增长 16.62%，环比下降 13.24%。2024 年 1-2 月，无线耳机出口量持续提升。2024 年 1 月，无线耳机出口量为 5882 万个，同比提升 29.16%；2024 年 2 月，无线耳机出口量为 4131 万个，同比提升 89.78%。

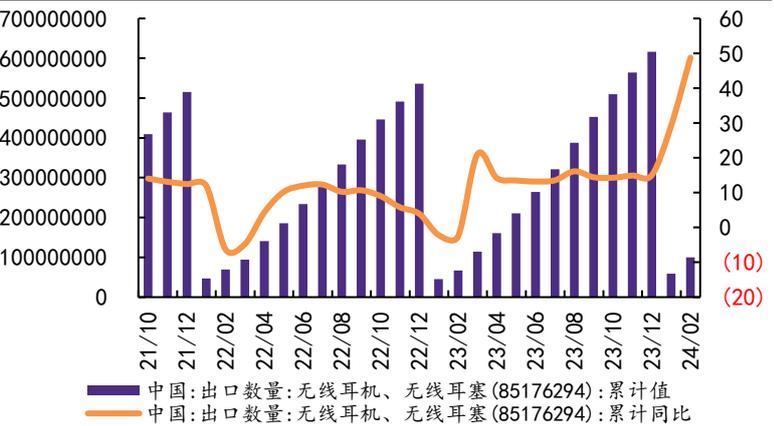
无线耳机技术已经充分成熟，相对于手机消费，无线耳机普及还有空间，随着无线耳机传感器的增多，产品体验感会更加出色，叠加价值量相对手机小，换机周期会显著快于手机。因此，随着国内的放开和经济复苏，我们继续看好无线耳机这类可穿戴设备的成长。

图表 27：无线耳机月度出口量（单位：个，%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

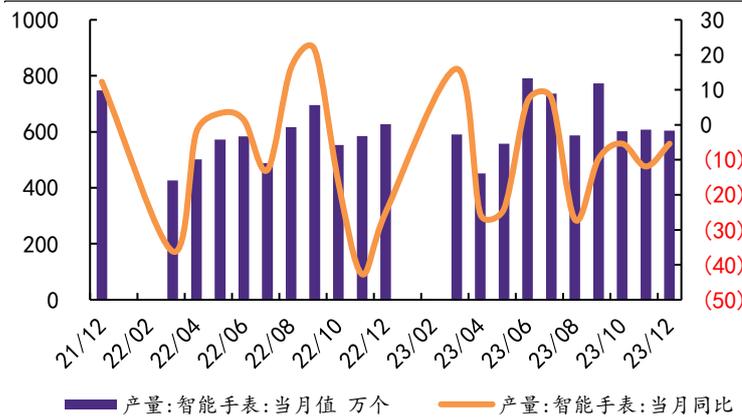
图表 28：无线耳机累计出口量（单位：个，%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

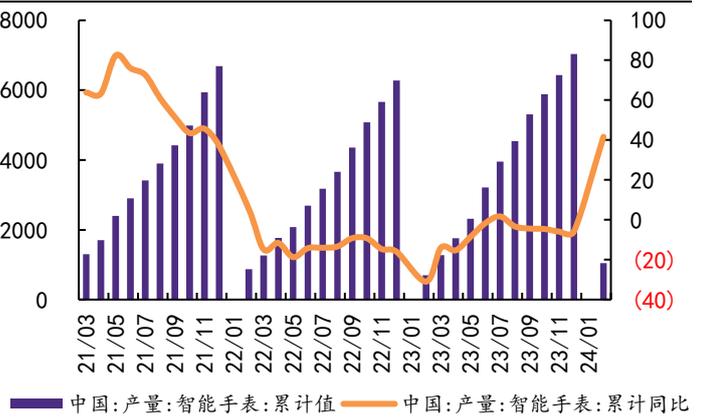
智能手表方面，与手机出货量情况类似，受疫情过后经济复苏不及预期的影响，消费者需求疲软，2023 年 1-12 月累计产量同比下降 5.90%。2024 年 1-2 月智能手表需求得到显著的修复，2024 年 2 月累计产量达到 1042 万个，同比提升 41.60%。

图表 29：中国智能手表月度产量（单位：万个，%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

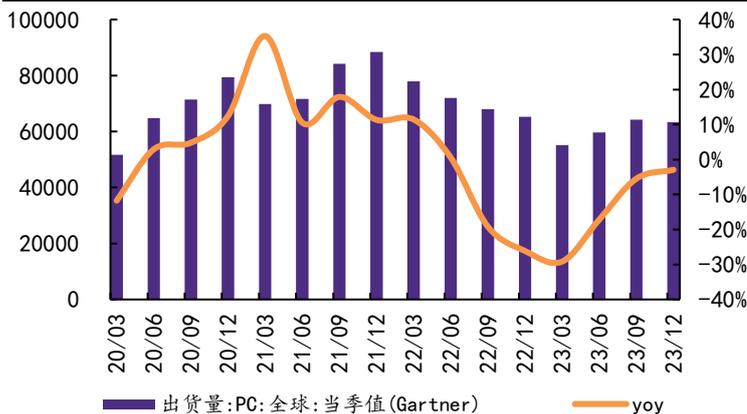
图表 30：中国智能手表累计产量（单位：个，%）



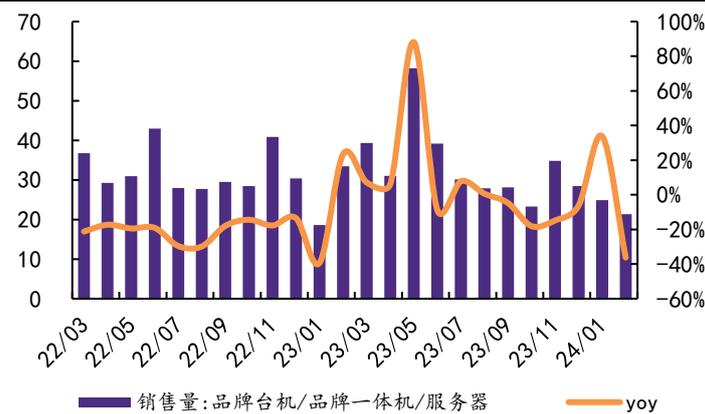
资料来源：wind，华鑫证券研究

个人电脑方面，2020-2021 年疫情带来居家办公需求快速上升，推动 PC 重回增长轨道，但疫情带来短期复苏结束后 PC 重回弱势的趋势，在 2022 年二季度开始进入拐点，2022 年 Q2 全球 PC 出货量同比微增 0.53%，远低于 Q1 的 11.44% 的增速，2023 年 H1，全球 PC 出货量继续下降，一季度同比下降 29.16%，二季度同比下降 17.16%；2023 年 Q3，出货量同比下降 5.47%，降幅有所收窄；2023 年 Q4，出货量同比下降 2.94%，降幅进一步收窄。品牌台式机/品牌一体机/服务器出货量自 2023 年 9 月开始连续 4 个月持续同比下滑，2024 年 1 月出货量同比提升 33.8%，2024 年 2 月出货量同比下降 36.26%。我们认为 AI 大模型落地将给 PC 产业链带来新的创新驱动力，PC 换机潮即将到来，预计 2024 年 PC 市场将恢复增长。

图表 31：全球 PC 季度出货量（单位：千台，%）



图表 32：中国台式机/服务器月度出货量（单位：万台）

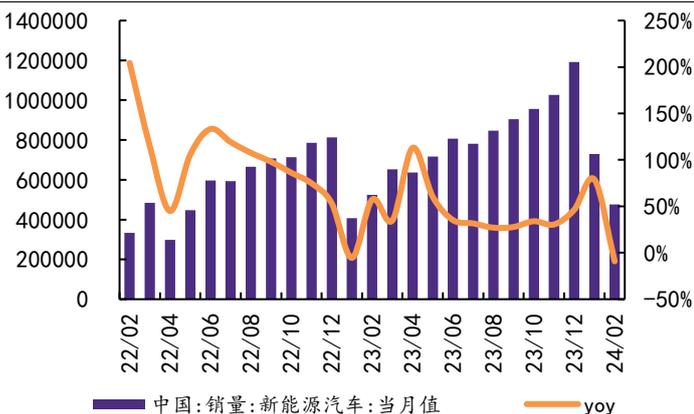


资料来源：wind，华鑫证券研究

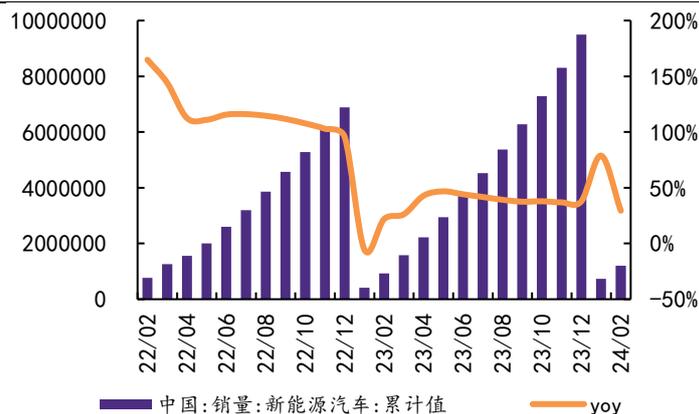
资料来源：wind，华鑫证券研究

随着汽车智能化和电动化带来更好的用户体验以及国家大力推广新能源车消费，新能源车销售依旧保持强劲势头，2023 年 1-4 季度分别取得 26.18%、60.92%、28.68%、38.68% 的同比增速。2023 年全年，新能源汽车累计销量达到 949.52 万辆，同比增长 37.88%。2024 年 2 月，新能源汽车销售量同比下降 9.19%，销量下滑的主要原因系受到二月份春节长假以及 1 月份提前透支的影响。我们认为随着汽车智能化发展的进一步深入，相关的电子零部件和汽车半导体的需求将持续保持高成长态势。

图表 33：中国新能源车月度销售量（单位：辆，%）



图表 34：中国新能源车累计销售量（单位：辆，%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

资料来源：wind，华鑫证券研究

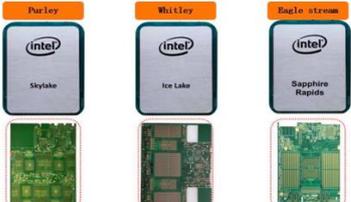
4、 近期新股

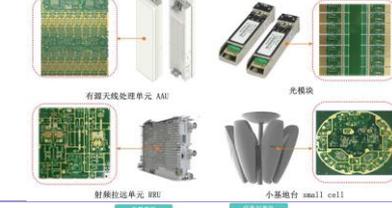
4.1、 广合科技(001389.SZ)：专注印制电路板供应商

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，自成立以来主营业务没有发生变化。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，市场布局覆盖“云、管、端”三大板块，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、通信、汽车电子、安防电子等领域，其中服务器用 PCB 产品的收入占比约 7 成，是公司产品最主要的下游应用领域，为全球大数据、云计算产业提供重要电子元器件供应。

公司以客户为中心，为客户持续提供品质稳定的产品和高效的服务，已积累了一批优质的客户资源，主要客户包括浪潮信息、DELL(戴尔)、Foxconn(鸿海精密)、Quanta Computer(广达电脑)、Jabil(捷普)、HP(惠普)、Cal-Comp(泰金宝)、Celestica(天弘)、Inventec(英业达)、海康威视、Honeywell(霍尼韦尔)、Flex(伟创力)等。此外，公司已和华为、中兴、联想等国内知名客户开展合作，优质的客户资源为公司进一步发展奠定了良好基础。公司是中国内资 PCB 企业中排名第一的服务器 PCB 供应商，2016 年到 2019 年连续获得中国服务器市场占有率第一的浪潮颁发的“年度优秀供应商奖”；2017 年至 2023 年上半年，共获得 22 次 DELL(戴尔)服务器 PCB 供应商评级第一名；公司在服务器 PCB 市场树立起良好的品牌形象。

图表 35：广合科技产品应用情况

主要产品	应用产品	应用产品	应用图例
		应用于高性能计算服务器、AI 运算服务器、存储服务器、交换机等数据中心的 核心设备。	
PCB	服务器	应用于服务器中主板、电源背板、硬盘背板、网卡、Riser 卡等核心部分。	
		应用于 Intel 发布的 Purley、Whitley 及 Eagle stream 各世代芯片平台的服务 器。	

消费电子	主要应用于打印机、笔记本电脑、耳机、健身器械等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。	
工业控制	主要应用于工业机器人、工业相机、伺服驱动器、地质探测钻头等。	
安防电子	主要应用于监控摄像头、烟雾报警器、人脸识别系统、门禁对讲系统等。	
通信领域	主要应用于有源天线处理单元 (AAU)、射频拉远单元 (RRU)、小基地台 (Small Cell)、光模块等。	
汽车电子	在汽车电子的应用包括汽车中控系统、照明系统、车载蓝牙、行车记录仪、倒车摄像头等。	
其他领域	公司产品类型较为丰富，在医疗器械、轨道交通、金融、mini LED 等领域均有广泛应用。	

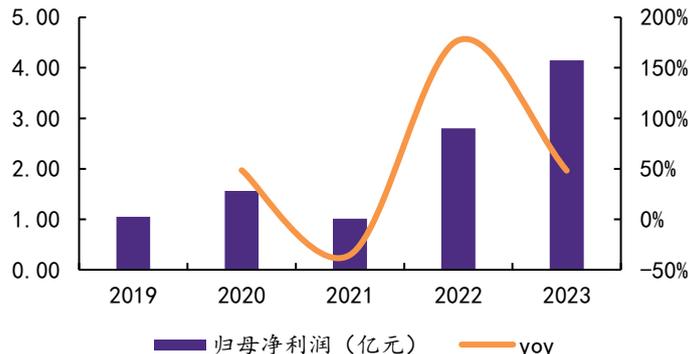
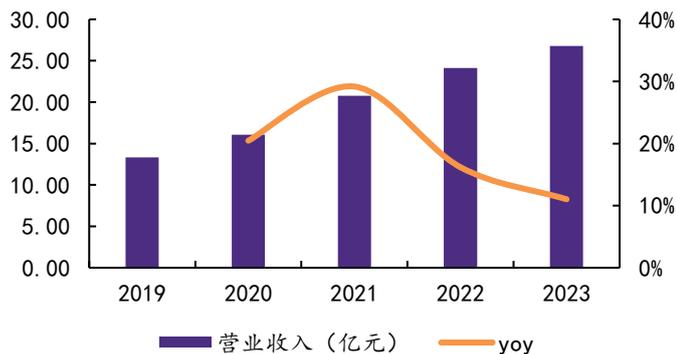
资料来源：广合科技招股说明书，华鑫证券研究

2023 年，公司实现营收 26.78 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 19.03%；2023 年实现归母净利润 4.15 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 41%。公司 2019-2023 年分别实现营业收入 13.34 亿元、16.07 亿元、20.76 亿元、24.12 亿元、26.78 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 20.46%、29.18%、16.18%、11.03%；2019-2023 年分别实现归母净利润 1.05 亿元、1.56 亿元、1.01 亿元、2.80 亿元、4.15 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 48.57%、-35.26%、177.23%、48.21%。

营收的增长主要是因为（1）我国 PCB 产业保持较快增长，以服务器为代表的下游领域需求旺盛；（2）生产能力不断提高促进收入规模增长。

图表 36：广合科技营业收入（亿元）

图表 37：广合科技归母净利润（亿元）



资料来源: wind, 华鑫证券研究

资料来源: wind, 华鑫证券研究

4.2、灿芯股份 (688691.SH)：一站式芯片定制服务供应商

公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。

依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，并入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单(第二批第一年)。公司凭借技术和服务的优异表现，获得了“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国半导体市场最佳设计企业奖”、“上海市浦东新区科学技术奖”、“2021 年度最具影响力 IC 设计企业”等多项荣誉奖项，并被权威媒体《电子工程专辑》(EE Times)评选为“全球 60 家最受关注的半导体初创公司”。

图表 38：灿芯股份产品应用情况

主要产品	服务内容	主要客户	终端应用
一站式芯片定制服务 功能性单丝	包括芯片定义、IP 选型及授权、架构设计、逻辑设计、物理设计、设计数据校验、流片方案设计等全流程芯片设计服务。公司在为客户提供芯片设计服务后，根据客户需求可继续为其提供芯片量产服务自用、厨卫	系统厂商，以及芯片设计公司	物联网 工业控制 消费电子 网络通信 智慧城市 人工智能 高性能计算

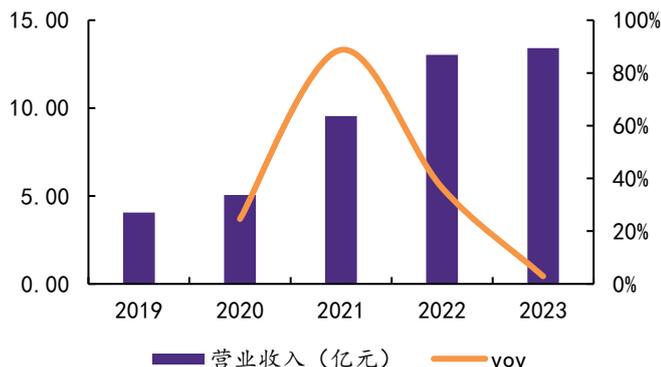
资料来源: 灿芯股份招股意向书, 华鑫证券研究

2023 年实现营收 13.41 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 34.81%；2023 年实现归母净利润 1.72 亿元，2019-2023 年 CAGR 为 142.18%。公司 2019-2023 年分别实现营业收入 4.06 亿元、5.06 亿元、9.55 亿元、13.03 亿元、13.41 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 24.63%、88.74%、36.44%、2.92%；2019-2023 年分别实现归母净利润 0.05 亿元、0.18 亿元、0.44 亿元、0.95 亿元、1.72 亿元，2020-2023 年 YOY 依次为 260.00%、144.44%、115.91%、

81.05%。

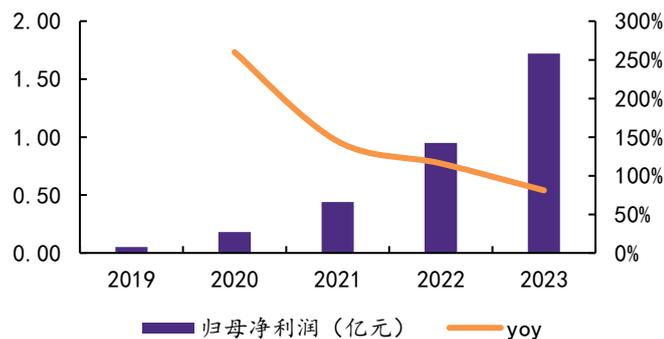
公司主营业务收入保持快速增长趋势，主要原因为：（1）随着逻辑工艺与特色工艺推陈出新，集成电路器件线宽不断缩小，设计风险与设计成本大幅增加，芯片定制服务整体行业需求将持续增长；（2）终端应用市场快速发展，芯片定制服务需求保持旺盛；（3）公司芯片设计能力持续提升，技术和市场竞争力不断加强；（4）公司能够快速满足客户对于芯片“自主、安全、可控”的迫切需求。

图表 39：灿芯股份营业收入（亿元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 40：灿芯股份归母净利润（亿元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

5、行业动态跟踪

5.1、半导体

SEMI：未来 4 年中国大陆 12 吋晶圆厂设备支出累计将达 1200 亿美元

3 月 23 日消息，近日，国际半导体产业协会（SEMI）发布《12 英寸晶圆厂 2027 年展望报告（300mm Fab Outlook Report to 2027）》指出，由于存储市场复苏以及对高性能运算和汽车应用的强劲需求，全球用于前端设施的 12 英寸（300mm）晶圆厂设备支出预估在 2025 年首次突破 1,000 亿美元，到 2027 年将达到 1,370 亿美元的历史新高。

SEMI 预估，全球 12 英寸晶圆厂设备投资预计将在 2025 年成长 20%至 1,165 亿美元，2026 年将成长 12%至 1,305 亿美元，还将在 2027 年创下历史新高。

SEMI 全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示，未来几年内 12 英寸晶圆厂设备支出预估将呈现大幅成长，反映出市场确实需要这样的生产能力，以满足不同市场对电子产品的成长需求，以及人工智慧创新带来的新一波应用浪潮；最新的 SEMI 报告也特别点出，政府增加半导体制造投资，对于促进全球经济和安全的关键重要性，这股趋势预计将有助于缩小重新崛起与新兴地区，以及亚洲历史上支出最高地区之间的设备支出差距。

在区域展望上，SEMI《12 英寸晶圆厂 2027 年展望报告》显示，在政府激励措施和芯片国产化政策的推动下，中国大陆未来四年将保持每年 300 亿美元以上的投资规模，累计投资将达 1200 亿美元，继续引领全球晶圆厂设备支出；受益于高性能运算（HPC）应用带动先进制程节点推进扩张和存储市场复苏，中国台湾和韩国的芯片供应商预期将提高相对应的设备投资。中国台湾的设备支出预计将从 2024 年的 203 亿美元增加到 2027 年的 280 亿

美元，排名第二；而韩国则将从今年的 195 亿美元增加到 2027 年的 263 亿美元，排名第三；美洲地区的 12 英寸晶圆厂设备投资预计将成长一倍，从 2024 年的 120 亿美元提高到 2027 年的 247 亿美元；而日本、欧洲和中东以及东南亚的支出预计将在 2027 年分别达到 114 亿美元、112 亿美元和 53 亿美元。

在各领域表现上，SEMI 预期，晶圆代工领域支出今年将下降 4% 来到 566 亿美元，部分原因是成熟节点 (>10nm) 投资预估将会放缓，然而为满足市场对生成式 AI、汽车和智慧边缘装置的需求，此领域在所有领域中仍保持最高的成长率，设备支出从 2023 年到 2027 年预计将带来 7.6% 年复合成长率 (CAGR) 达到 791 亿美元。

数据传输频宽对于 AI 服务器的运算性能至关重要，带动高带宽内存 (HBM) 强劲需求，导致内存技术的投资增加。内存存在所有领域中排名第二，2023 年到 2027 年的年复合成长率将达到 20%。DRAM 设备支出预计将在 2027 年提高到 252 亿美元，年复合成长率为 17.4%；而 3D NAND 的投资预计将在 2027 年达到 168 亿美元，年复合成长率为 29%。

SEMI 预计到 2027 年，模拟 (Analog)、微型 (Micro)、光电 (Opto) 和分离 (Discrete) 元件领域的 12 英寸晶圆厂设备投资将分别增加至 55 亿美元、43 亿美元、23 亿美元和 16 亿美元。

SEMI 在《12 英寸晶圆厂 2027 年展望报告》中列出了全球 405 座设施和生产线，包括预计将在未来四年内开始营运的 75 座设施。

(资料来源：芯智讯)

HBM 全年供给增幅可达 260%

根据 TrendForce 集邦咨询统计，预计截至 2024 年底，整体 DRAM 产业规划生产 HBM TSV (硅通孔) 的产能约为 250K/m，占总 DRAM 产能 (约 1800K/m) 约 14%，HBM 供给数量年增长率可达 260%。此外，2023 年 HBM 产值占比之于 DRAM 整体产业约 8.4%，至 2024 年底将扩大至 20.1%。

机构分析师表示，HBM 高带宽存储芯片晶圆的尺寸相比同容量、同制程的 DDR5 大 35%~45%，然而良率 (包含 TSV 封装良率) 要低 20%~30%。生产周期方面，HBM 的制造工艺 (包含 TSV) 较 DDR5 长 1.5~2 个月不等。

由于 HBM 芯片生产周期更长，从投片到产出、封装完成需要两个季度以上。因此，急需取得充足供货的买家更早锁定订单。

根据 TrendForce 了解，大部分针对 2024 年度的订单均已递交给供应商。

该机构同时预估了三大 HBM 厂商的 HBM/TSV 产能，其中三星 HBM TSV 年产能将在 2024 年达到 130K/m。SK 海力士次之，可达 120~125K/m；美光相对较少，仅为 20K/m、目前三星、SK 海力士规划提高 HBM 产能最积极，其中 SK 海力士在 HBM3 市场的占有率逾 90%，而三星将连续数个季度紧追，未来将受惠于 AMD MI300 芯片的逐季放量。

(资料来源：集微网)

传三星 3nm 良率已提升 3 倍，第二代 3nm 的 PPA 有望赶上台积电 N3P

3 月 22 日消息，知名爆料人 Revegnus 通过社交平台 X 爆料称，三星的 3nm 制程良率一开始虽然只有 10~20%，但最近良率已经拉升至原来的三倍以上，即良率最高已经达到了 60%，未来整体表现有机会追上台积电。

虽然目前三星 3nm GAA (环绕栅极) 制程良率大幅提高，但依旧低于使用现有“鳍式场

效”（FinFET）制程的台积电 3nm 工艺。但三星对其第二代 3nm 制程期望甚高，据传其性能、功耗及面积（Performance、Power、Area，简称 PPA）表现出众，可能赶上台积电的 N3P。

Revegnus 表示，三星 3nm 制程的能源效率（power efficiency）、逻辑区域（logic area）都比上一代的 4nm FinFET 改善 20~30%。

值得注意的是，据韩国媒体 TheElec 报导，三星共同执行长庆桂显（Kyung Kye-hyun）3 月 20 日在年度股东大会预测，今年的半导体相关营收有望重返 2022 年衰退前的水位。

庆桂显指出，存储业务已于今年 1 月已转亏为盈，今年将彻底恢复元气，除了高频宽内存（HBM）外，三星公司也在针对开放性高速互连通讯协议 CXL（Compute Express Link）、内存处理器（Processor In Memory, PIM）跟客户接洽，结果很快就能出炉。

三星晶圆代工事业总裁崔时荣（Siyoung Choi）在同一场合表示，虽然英特尔开始谈论 1.4nm 制程，但三星及台积电也都有相关制程规划。他说，客户需要的是能稳定供应、产品具竞争力的晶圆代工商，三星 4nm 制程的良率已成熟。

崔时荣还表示，三星第二代 3nm 制程预计今年下半投产，2nm 制程的投产时间则是明年。

（资料来源：芯智讯）

三星全面发力先进封装，今年相关营收将挑战 1 亿美元

3 月 21 日消息，在 AI 芯片热潮的带动下，先进封装需求大爆发，而目前在先进封装领域，台积电可谓是一家独大，拿下了大部分的 AI 芯片的先进封装订单。不过，韩国芯片巨头三星电子也在积极切入先进封装领域，近日还喊出了今年先进封装营收将挑战突破 1 亿美元新高的口号。

据路透社、韩联社等外媒报导，在 3 月 20 日召开的三星年度股东大会上，三星高管表示，尽管今年经济情势不确定性仍高企，不过随着 AI 大时代来临，科技创新也带来了更多新机遇，将积极拓展相关业务，包括 AI 内存、先进封装、智慧终端（On-device AI）、机器人和数字医疗等新兴领域，激发新的成长动能。

三星于 2023 年 12 月成立了先进封装业务团队（AdVanced Package Business Team），为装置解决方案（Device Solutions）事业群辖下的部门。

根据此前据韩国媒体 The Elec 的报道显示，为增强先进封装代工能力，三星开始导入混合键合（hybrid bonding）技术，预计用于下一代 X-Cube、SAINT 等先进封装。

据了解，混合键合与现有键合方法相比，可提高 I/O 和布线长度。三星最新投资是为了加强先进封装能力，推出采用混合键合的 X-Cube。业界猜测，混合键合也可应用于三星今年开始推出的 SAINT（三星先进互连技术）平台，包括三种 3D 堆叠技术，即 SAINT S、SAINT L 和 SAINT D。

其中，SAINT S 是将 SRAM 垂直堆叠在 CPU 等逻辑芯片上；SAINT L 是将逻辑芯片堆叠在逻辑芯片，或应用处理器（AP）堆叠；SAINT D 则是 DRAM 和 CPU、GPU 等逻辑芯片垂直堆叠。

据了解，晶圆代工龙头台积电的 SoIC（系统整合芯片）也是提供混合键合的 3D 封装服务，设备同样也是由应用材料和贝思半导体共同提供。英特尔也将混合键合技术应用在其 3D 封装技术 Foveros Direct，并于去年商业化。

业界预期，三星对混合键合设施的投资有望赢得 NVIDIA 和 AMD 等大客户青睐，因为晶圆厂客户对混合键合需求正不断增加。

另外，目前大热的 HBM（高带宽内存）的生产也依赖于先进封装技术。作为目前仅有的三大 HBM 供应商之一，三星也将为英伟达的 AI 芯片供应 HBM，不过目前三星的 HBM 仍未通过英伟达的认证。数名分析人士指出，三星 HBM3 的良率目前只有 10~20%，SK 海力士的 HBM3 良率却已达到了 60~70%。

在此次的三星年度股东大会上，三星共同执行长庆桂显（Kye-Hyun Kyung）表示，投资先进封装效果将在下半年全面显现，并利用 IC 设计、制造、封测的一条龙服务优势，全力抢攻高频宽内存（HBM）市场。

（资料来源：芯智讯）

5.2、消费电子

预计 2024 年全球 AI PC 出货量可达 4800 万台

研究机构 Canalys 于 3 月 18 日公布的最新预测显示，预计 2024 年全球人工智能电脑（AI PC）出货量可达 4800 万台，在 PC 市场占比约为 18%。2025 年，预计 AI PC 出货量将超过 1 亿台，占比 40%。该机构预测 2024~2028 年期间，复合年均增长率可达 44%，2028 年 AI PC 出货量将超过 2 亿台。

目前英特尔等厂商均已推出集成有专用人工智能加速单元（如神经处理单元 NPU）的 PC 处理器，业界预计 AI PC 将释放全新生产力，提高效率与实现个性化功能。

Canalys 分析师 Ishan Dutt 表示，人工智能加速芯片在个人计算领域的广泛应用，将带来变革。AI PC 将带来更高的能效、更高的安全性，并降低与运行人工智能负载相关的成本。这一新兴电脑类别为软件开发商和硬件供应商，开辟了新的创新领域，也将为消费者、教育及商业场景客户带来引人注目的应用。

该机构预测，与未集成 NPU 的同类 PC 相比，AI PC 将溢价 10%~15%。随着搭载率的提升，2025 年价格 800 美元及以上的 PC，将有一半支持人工智能计算，到 2028 年这一比例将增至 80%。这有助于推动 PC 市场整体价值从 2024 年的 2250 亿美元增长至 2028 年的 2700 亿美元以上。

（资料来源：集微网）

小米 2023 年营收 2710 亿元，净利润大增至 193 亿元 毛利创新高

集微网消息，小米集团 3 月 19 日召开董事会，并发布 2023 年全年财报。小米集团 2023 年全年总营收 2710 亿元，经调整净利润 193 亿元，同比增长 126.3%；此外整体毛利率 21.2%，创历史新高。

小米集团表示，2023 年小米的认知、技术和战略进展实现全新突破。继续坚定不移投入底层核心技术，研发支出 191 亿元，同比增长 19.2%。小米澎湃 OS 系统覆盖范围持续扩大，「人车家全生态」战略稳步推进。AIoT 平台已连接的 IoT 设备（不含智能手机、平板及笔记本电脑）数达 7.40 亿，同比增长 25.5%。

手机方面，小米高端化战略全面跨越，2023 年全年智能手机收入 1575 亿元手机毛利率达 14.6%创历史新高，同比增长 5.6%。2023 国内 4K-6K 价位段智能手机市占率达 16.9%，同比提升 9.2 个百分点；2023 年 Q4 该价位段智能手机销量排名第一，市占率增至 28.2%。

智能生态方面，2023 年小米 IoT 与生活消费产品收入达 801 亿元，毛利率 16.3%再创历史新高。拥有 5 件及以上连接至 AIoT 平台设备用户数同比增长 25.3%，米家 App 的月活用户数同比增长 13.2%，达 8580 万。此外，小米电视出货量 2023 年稳居全球前五，平板产

品出货量中国大陆排名前三，全球出货突破 500 万台。可穿戴腕带设备在全球、中国大陆市场均排名第二，小米 TWS 真无线耳机排名中国大陆第二。

互联网服务收入方面，全年共收入 301 亿元，毛利率达 74.2%。其中广告业务收入 205 亿元，境外互联网服务收入 84 亿元，游戏业务收入 44 亿元。

小米表示，截至 2023 年末，小米研发人员共 17800 人，占比 53%。5 年来研发支出持续增长。小米同时强调 2040 年碳中和承诺，以及践行企业社会责任。小米公益基金会用于扶危济困工作的累计捐款超过 1.62 亿元，向国家自然科学基金会捐赠 1 亿元。

(资料来源：集微网)

国产折叠屏手机扎堆发布 供应链厂商有望持续受益

进入 2024 年，折叠屏手机依然是各厂商重点打造的产品。今年 2 月，华为宣布推出新一代纵向折叠屏手机华为 Pocket 2，并传出正在研发三折手机，最快将于二季度推出三折手机。

值得提及的是，在华为 Mate X5、Mate X3 和 Pocket S 等折叠手机的带动下，其销量迅速增长。除了华为外，荣耀、小米、三星、联想、vivo、OPPO 等企业也均计划在 2024 年推出新款折叠屏手机，部分将小折叠作为发力方向之一。

折叠屏手机出货量的迅猛增长，也让国产供应链厂商受益。

从产业链来看，折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板，此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升，与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。

目前，国内已有多家上市公司已经进入折叠屏手机供应链核心环节。例如折叠机屏幕大多由京东方、维信诺、TCL 华星及深天马供应；UTG 盖板部分则由蓝思科技、长信科技和凯盛科技提供；至于铰链部分则是由精研科技、东睦股份等量产供应。

除了 UTG、铰链等产品外，在华为、荣耀等高端手机的带动下，零配件的需求量也迅速提升。据供应链透露，华为正在“扫货” CMOS 图像传感器等关键零部件，致使高端芯片等核心零部件供应趋紧，WiFi 芯片、存储芯片等部分产品价格于今年 Q1 已经上涨 20%左右。同时部分供应商已将供应量提高了 25%至 30%。

Wit Display 首席分析师林芝表示，“手机厂商均在扩充 2024 年折叠屏手机目标，随着主力厂商发力多形态折叠屏产品，相关供应量将空前增加，供应链厂商也正在为满足华为等大厂供应，在折叠屏零部件、屏幕等方面积极备货。”

(资料来源：集微网)

AI PC 周期加速，产业链有望迎来量价齐升

AMD 日前在京举办 AI PC 创新峰会，携手产业链合作伙伴，展示了其在中国 AI PC 生态系统中的发展势头，并将领先的 AI 计算带给消费者。AMD 董事会主席及首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 博士同众多 AMD 高管出席，展示了 AMD 在 AI PC 领域领先的创新能力，强大产品路线图，众多变革性的创新体验，以及与中国产业链伙伴的深入合作。

目前，AMD 数百万 AI PC 已实现出货，成为 AI PC 领域当仁不让的引领者。此外，3 月 21 日晚，微软举办主题为“办公新时代”的线上新品发布会，发布 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6，新品将搭载基于英特尔酷睿 Ultra 或高通骁龙 X Elite 的处理器，配备新一代 NPU，以增强 AI 性能。

2024 年无疑是 AI PC 元年，头部厂商纷纷布局。苹果本月也发布新款 MacBook Air，搭载 M3 芯片，称新款 MacBook Air 为全球最佳的 AI 消费级笔记本电脑。

Canalys 预测 2024 上半年将出现 AI 赋能模型浪潮。鉴于在 2024 年末推出的最新 Windows 操作系统将发布经 AI 强化后的功能，以及 AI 工具在商业和生产软件中的广泛应用，AI PC 市场将在 2025 年和 2026 年有望实现快速增长。Canalys 预测到 2027 年，AI PC 全球出货量预计超过 1.7 亿台，在总个人电脑出货量的占比超 60%，2023-2027 年 AI PC 出货量 CAGR 达 63%。

落实到产业链具体环节上，相关上市公司中：蓝思科技与苹果、微软、三星等消费电子、PC 行业全球知名客户均有深度合作，提供金属结构件、玻璃防护面板等零组件和整机组装，2016 年开始为微软 Surface 供货。博杰股份的测试解决方案可以支持 AI PC 类产品测试需求，与 PC 行业头部客户均有业务合作。亿道信息已在大语言、AIGC 等主流模型积极跟进，可以在 PC 侧通过 Stable Diffusion 等主流大模型生成文字、图像。目前公司 AI PC 还处于项目研发阶段。

(资料来源：集微网)

5.3、汽车电子

联发科结合 NVIDIA 技术推出 Dimensity Auto 座舱平台，为汽车带来先进的 AI 技术

2024 年 3 月 19 日 - 联发科技 (MediaTek) 今日在英伟达 (NVIDIA) GTC 大会上推出一系列结合 AI 技术的 Dimensity Auto 座舱平台系统单芯片 (SoC)：CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1，这四款产品皆支持 NVIDIA DRIVE OS 软件，汽车制造商可借助 Dimensity Auto 平台覆盖从豪华 (CX-1) 到入门级 (CV-1) 的细分市场，将优质的 AI 座舱体验带入新一代智能汽车中。

Dimensity Auto 座舱平台芯片组整合了先进的 Armv9-A 架构以及由 NVIDIA 下一代 GPU 加速的 AI 运算和 NVIDIA RTX 图形处理技术，支持深度学习功能。Dimensity Auto 座舱平台支持在车内运行大语言模型 (LLMs)，可赋能车载语音助手、多屏显示、驾驶警觉性监测等先进的 AI 安全和娱乐应用。这些应用在汽车端侧运行不仅能提高安全性，还享有高响应速度和低延迟优势。Dimensity Auto 座舱平台采用硬件级安全设计，符合新推出的汽车安全标准，可进一步保护用户数据。

MediaTek 资深副总经理、运算联通元宇宙事业群总经理游人杰表示：“正如在移动通信市场带来的个性化、直觉性的计算革命，生成式 AI 也正在改变汽车产业。Dimensity Auto 座舱平台解决方案提供易于扩展的软硬件平台，有助于汽车制造商将 AI 功能轻松部署到全系车型，这将为汽车产业带来全新的 AI 座舱娱乐体验。”

Dimensity Auto 座舱平台将车内娱乐体验提升至新境界。整合 NVIDIA RTX GPU 可支持光线追踪技术，为游戏带来逼真的光影视觉效果，同时支持 AI 图像放大和帧生成技术，可提供清晰流畅的游戏体验。此外，Dimensity Auto 座舱平台还支持先进的网络连接和内存技术，不同乘客可在不同显示屏上同时观看流媒体视频等内容，还可通过 AI 技术实现实时视线校正和音质增强等高阶视讯功能。

NVIDIA 汽车业务部副总裁 Ali Kani 表示：“生成式 AI 和加速计算正在重塑汽车产业。新推出的 Dimensity Auto 芯片组结合了 NVIDIA 先进的图形处理和 AI 技术，将为各个级别车型的用户带来远超以往的座舱体验，提升安全防护与连网功能。”

此外，Dimensity Auto 座舱平台芯片组 CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1 更高度整合多项功能，可帮助汽车制造商降低物料清单 (BOM) 成本。例如，内建的多摄像头 HDR ISP 可支持

前置、车内和全景摄像头，为行车安全增加保障；同时也整合了音频 DSP，支持先进的语音助手功能，让驾驶员无需手离方向盘也能获取资讯并使用信息娱乐系统。

MediaTek Dimensity Auto 系列平台为汽车产业提供了完整的产品组合。除了 Dimensity Auto 座舱平台，还包括 Dimensity Auto 联接平台，可提供高速车载通信和高性能 Wi-Fi 网络连接技术；Dimensity Auto 驾驶平台提供可扩展的完整开放平台，由 NVIDIA 提供智能辅助和自动驾驶解决方案；Dimensity Auto 关键组件则为智能网联汽车提供高可靠性的车规级芯片组和独立零部件。

（资料来源：芯智讯）

余承东：华为车 BU 业务今年将扭亏为盈！

近日，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在中国电动汽车百人会论坛（2024）上表示，从今年起，由于合作伙伴打造的中高端车型的大卖，能实现扭亏为盈的目标。华为智选车业务今年前三月已经完成扭亏，车 BU 接近盈亏平衡的边缘，预计从 4 月份开始应该能实现扭亏为盈，实现良性的正向发展。

余承东表示，华为与奇瑞合作的智界 S7 因为芯片缺货和工厂搬迁，耽误了上市和量产。预计从 4 月份开始可以恢复到正常状态。此外，余承东透露，与江淮合作的车型售价将达到百万级别。此外，余承东透露，与江淮合作的车型售价将达到百万级别。

资料显示，华为车 BU 于 2019 年 5 月正式成立，下设 15 个二级部门，包括智能驾驶产品部、MDC 产品部、智能车控产品部、智能车云产品部、智能驾驶产品部、智能座舱产品部、智能汽车解决方案部等。华为车 BU 与四大 BG 并列，同属一级部门，隶属于 ICT 管理委员会管理。

（资料来源：芯智讯）

DDI 芯片厂商看好 OLED、汽车显示领域，今年前景乐观

集微网消息，近日显示驱动芯片（DDI）领域厂商透露，对 OLED 和汽车显示市场领域的前景持乐观态度，预计今年销售将小幅增长。

包括 ChipMOS Technologies（南茂科技）和 Chipbond Technology（欣邦科技）在内的 DDI 后端厂商表示，多屏显示设备的普及将创造新机遇，虽然目前电视、智能手机销售不振，但汽车面板和 OLED DDI 的需求仍相对强劲。

目前汽车应用产品约占南茂科技 DDI 产量的 25%；高端产品保持稳定，但中低端产品产能利用率有所下降。不过，该公司仍对 2024 年 DDI 后端业务的小幅增长持谨慎乐观态度。

欣邦科技观察，尽管需求反弹并不确定，但 DDI 库存消耗预示着一种积极趋势。2024 年半导体行业将逐步复苏，外加下半年欧洲杯、美洲杯、巴黎奥运会等全球重大体育赛事，预计将推动电视应用领域 DDI 需求增长。

行业分析师表示，虽然用于智能手机的 DDI 补货需求已经停止，但 a-si/LTPS/AMOLED 面板订单却在增加，中国大陆智能手机厂商加快应用本地供应商提供的柔性电路板。分析师预测，2024 年中国大陆手机品牌将更积极采用本地 AMOLED 显示屏，这类产品在安卓智能手机中的应用比例将从 42% 上升至 49%。

此外，苹果手机 AMOLED 面板渗透率已在 2021 年达到 80%，后续增长预计保持温和。所有迹象表明，2024 年上半年手机市场对 AMOLED 面板需求将保持稳定。

（资料来源：集微网）

6、行业重点公司公告

图表 41：本周重点公司公告

公告日期	证券代码	公告标题	主要内容
2024-03-19	300115.SZ	长盈精密:2023 年年度报告	长盈精密发布 2023 年年度报告，2023 年实现营收 137.22 亿元，同比减少 9.74%；实现归母净利润 0.86 亿元，同比增长 102.23%。
2024-03-19	300115.SZ	长盈精密:关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告	公司 2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。
2024-03-19	600237.SH	铜峰电子:2023 年年度报告	铜峰电子发布 2023 年年度报告，2023 年实现营收 10.83 亿元，同比增长 4.11%；实现归母净利润 0.87 亿元，同比增长 17.30%。
2024-03-19	600237.SH	铜峰电子:关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告	公司 2023 年度拟不分配、也不进行公积金转增股本。
2024-3-20	300354.SZ	东华测试:2023 年度业绩预告修正公告	东华测试修正了前次业绩预告，最新预计归母净利润 0.85 - 1.10 亿元，同比减少 9.67% - 30.20%；最新预计扣非归母净利润 0.82 - 1.07 亿元，同比减少 8, 84% - 30.14%。
2024-03-21	688195.SH	腾景科技:2023 年年度报告	腾景科技发布 2023 年年度报告，2023 年实现营收 3.40 亿元，同比减少 1.29%；实现归母净利润 0.42 亿元，同比减少 28.72%。
2024-03-21	688195.SH	腾景科技:2023 年年度利润分配方案公告	公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本为 1.29 亿股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 0.13 亿元（含税），占公司 2023 年度净利润的 31.05%。
2024-03-21	688337.SH	普源精电:2023 年年度报告	普源精电发布 2023 年年度报告，2023 年实现营收 6.71 亿元，同比增加 6.34%；实现归母净利润 1.08 亿元，同比增加 16.72%。
2024-03-21	688337.SH	普源精电:2023 年年度利润分配方案公告	公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1.85 亿股，以此计算拟派发现金红利合计 0.93 亿元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润比例为 85.74%。
2024-03-22	002273.SZ	水晶光电:2023 年年度报告	水晶光电发布 2023 年年度报告，2023 年实现营收 50.76 亿元，同比增加 16.01%；实现归母净利润 6.00 亿元，同比增加 4.15%。
2024-03-22	002273.SZ	水晶光电:关于 2023 年度利润分配预案的公告	公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。如以公司现有总股本 13.91 亿股扣除公司回购专户上已回购股份 0.09 亿后的股本总额 13.82 亿股为基数计算，预计派发现金股利 4.15 亿元（含税）。
2024-03-22	688372.SH	伟测科技:2023 年年度报告	伟测科技发布 2023 年年度报告，2023 年实现营收 7.37 亿元，同比增加 0.48%；实现归母净利润 1.18 亿元，同比减少 51.57%。
2024-03-22	688372.SH	伟测科技:2023 年度利润分配预案的公告	公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1.13 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 0.36 亿元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
2024-03-23	600563.SH	法拉电子:2023 年年度报告	法拉电子发布 2023 年年度报告，2023 年实现营收 38.80 亿元，同比增加 1.14%；实现归母净利润 10.24 亿元，同比增长 1.72%。。
2024-03-23	600563.SH	法拉电子:2023 年度利润分配预案的公告	公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年度末股本 2.25 亿股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 20 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 4.50 亿元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 43.94%，利润分配后结存未分配利润为 36.06 亿元。

资料来源：Wind，华鑫证券研究

长盈精密:2023 年年度报告

2023 年,公司营业收入为 137.22 亿元,同比减少 9.74%,其中主营业务占营业收入的 99.36%。归属于上市公司股东的净利润为 0.86 亿元,同比增长 102.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.19 亿元,同比增长 10.26%;经营性现金流继续增长,净额达 22.28 亿元,同比增长 127.83%;资产状况良好,净资产和总资产不断增长,分别达 58.03 亿元及 185.73 亿元。

2023 年,全球经济整体呈现弱复苏态势,地缘政治冲突对全球经济复苏态势带来较强负面冲击。在面临上半年终端需求疲软的压力之下公司紧跟行业发展趋势和客户需求,稳扎稳打,在收入规模同比下降的情况下实现了归属于上市公司股东净利润的翻番。这主要是因为(1)在新项目上取得重大进展,包括 XR (AR/VR/MR) 以及智能手机项目;(2)2023 年新能源业务收入 35.40 亿元,同比增长 43.46%;(3)多点布局海外生产基地建设;(4)公司持续加强技术创新,从新材料和新工艺两个维度升级精密制造能力;(5)加强团队建设,完善薪酬激励体系。

长盈精密:关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

(一) 公司 2023 年度利润分配预案

根据天健会计师事务所审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 0.86 亿元,其中母公司实现的净利润为-1.09 亿元,公司 2023 合并报表累计可供分配利润为 17.58 亿元,其中母公司累计可供分配利润为 12.77 亿元。公司 2023 年度利润分配预案为:公司 2023 年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

(二) 公司拟不进行利润分配的原因

鉴于目前公司处于重要发展时期,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本,以实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。2023 年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》的规定。

(三) 公司未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求,满足公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,公司的未分配利润结转以后年度分配。

铜峰电子:关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

2023 年,公司营业收入为 10.83 亿元,同比增长 4.11%;其中:薄膜材料实现营业收入 4.38 亿元,与去年同期相比下降 9.33%;电容器实现营业收入 5.06 亿元,与去年同期相比增加 23.71%。归属于上市公司股东的净利润为 0.87 亿元,同比增长 17.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.82 亿元,同比增长 25.65%;经营性现金流继续增长,净额达 2.16 亿元,同比增长 161.58%;资产状况良好,净资产和总资产不断增长,分别达 17.08 亿元及 24.02 亿元。

2023 年,国内经济克服多重超预期因素冲击,实现了平稳增长。在经济形势持续回升向好的基础上,公司也紧紧抓住国家实施经济结构优化和升级的机遇,以项目为带动,积极调整市场策略,持续优化产品结构,重点布局新能源、风电光伏、轨道交通、输变电、工业控制等新应用领域,增强发展后劲。

铜峰电子:关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

经容诚会计师事务所审计, 2023 年公司实现的净利润为 0.86 亿元, 加上年初未分配利润-2.29 亿元, 截止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-1.46 亿元。

鉴于 2023 年度母公司没有可供分配的利润, 同时为保障公司正常生产经营, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 综合考虑公司长期发展和短期经营实际, 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定, 拟定 2023 年度利润分配预案为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

东华测试:2023 年度业绩预告修正公告

(一) 修正后的预计业绩

东华测试修正了 2023 年度业绩预告, 原预计归母净利润 1.40 - 1.75 亿元, 最新预计 0.85 - 1.10 亿元, 同比减少 9.67% - 30.20%; 原预计扣费归母净利润 1.37 - 1.72 亿元, 最新预计 0.82 - 1.07 亿元, 同比减少 8, 84% - 30.14%。

(二) 业绩修正原因:

1. 随着年度审计工作的深入开展, 基于谨慎性原则, 对部分销售合同收入确认条件进行再次分析, 由于部分客户自身项目延期交付、验收手续不完善等原因, 调减 2023 年度部分主营业务收入, 受收入调整影响, 导致净利润变化超出业绩预告区间。公司将持续重点关注、推进该等客户合同履行情况, 前述调整的收入预计会在 2024 年度确认, 该项收入的调整不会影响公司正常的生产经营活动。
2. 本次更正涉及公司某项无形资产, 经查实, 公司外购某软件系统实为客户所需的代购软件, 经与会计师沟通, 将该无形资产账面价值 788 万元结转为营业成本。

腾景科技:2023 年年度报告

2023 年, 公司营业收入为 3.40 亿元, 同比减少 1.20%, 较上年同期基本持平; 归属于上市公司股东的净利润为 0.42 亿元, 同比减少 28.72%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.36 亿元, 同比减少 24.14%; 经营性现金流继续增长, 净额达 0.67 亿元, 同比增长 21.12%; 净资产和总资产由所增长, 分别达 9.03 亿元及 10.87 亿元, 并分别同比增长 2.68% 和 6.85%。

报告期内, 受光通信下游客户去库存影响, 海外电信侧、传统数据中心侧的需求阶段性放缓, 公司光通信领域收入下降; 工业激光下游需求稳步复苏, 收入恢复增长; 公司积极开发生物医疗、AR、车载、半导体设备等领域的业务, 开拓高端光学模组产品在半导体设备、生物医疗的应用并取得销售订单的增长。为持续拓展各应用领域市场, 公司积极参加了国内外多场光电行业展会, 把握行业最新技术动态和市场需求动态, 努力拓展优质客户, 通过系列举措进一步延伸公司产品线, 拓宽业务增长空间。公司始终高度重视技术创新和研发投入, 紧跟行业技术发展趋势及高端元器件国产化进程, 积极进行光学光电子行业的技术研究和前瞻布局, 持续进行新技术、新产品的开发与应用。

报告期内, 公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 28.72%, 主要是由于营

业收入较上年同期基本持平，但新增关键生产设施的投入使用增加了折旧、摊销等固定成本支出，尚未有效发挥规模效应；并且继续加大研发投入所致。

腾景科技:2023 年年度利润分配方案公告

根据致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配的利润为 1.60 亿元。经公司董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本为 1.29 亿股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 0.13 亿元（含税），占公司 2023 年度净利润的 31.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

普源精电:2023 年年度报告

2023 年，公司营业收入为 6.71 亿元，同比增长 6.34%；归属于上市公司股东的净利润为 1.08 亿元，同比增长 16.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.60 亿元，同比增长 27.60%；公司毛利率水平改善，达到 56.45%，同比增长 4.06 个百分点，经营性现金流净额 -0.18 亿元，同比减少 1.23 亿元；净资产和总资产由所增长，分别达 28.89 亿元及 32.66 亿元，并分别同比增长 12.70% 和 17.09%。

影响公司营业收入的主要因素分析如下：

1. 自研核心技术平台：搭载公司自研核心技术平台数字示波器产品的销售占整体示波器销售比例为 76.03%，同比提升 5.64 个百分点，对公司营业收入增长起到重要拉动作用。
2. 旗舰数字示波器：报告期内，公司高端（带宽 \geq 2GHz）和高分辨率（垂直分辨率 \geq 12bit）数字示波器占整体数字示波器销售金额比例已经达到 54.29%，保持稳定增长趋势。
3. 射频类仪器销售收入：报告期内，公司射频类仪器的销售收入同比增长 14.41%。
4. DHO 系列数字示波器产品：报告期内，公司 DHO 系列产品销售收入同比提升 193.79%。

普源精电:2023 年年度利润分配方案公告

经德勤华永会计师事务所审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，普源精电 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 1.08 亿元，母公司 2023 年末可供分配利润为人民币 1.23 亿元，资本公积余额为人民币 24.94 亿元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1.85 亿，以此计算拟派发现金红利合计 0.93 亿元（含税）。本年度公司现金

分红金额占归属于母公司股东的净利润比例为 85.74%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准通过后实施。

水晶光电:2023 年年度报告

2023 年，公司营业收入为 50.76 亿元，同比增长 16.01%；归属于上市公司股东的净利润为 6.00 亿元，同比增长 4.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.23 亿元，同比增长 2.72%；经营性现金流继续增长，净额达 12.30 亿元，同比增长 46.14%；净资产和总资产由所增长，分别达 86.03 亿元及 112.55 亿元，并分别同比增长 5.60% 和 9.44%。

2023 年是公司“十四五”战略落地的攻坚之年，尽管中国经济总体回升向好，但仍面临全球通货膨胀、地缘政治冲突加剧、消费电子市场需求疲软等不利因素的挑战。公司以“聚焦战略打胜仗、重构组织促转型、刷新文化助成长”为经营方针，坚定贯彻落实年度工作规划和“十四五”战略布局，巩固消费类电子业务基石，实现车载光电业务快速发展，取得 AR/VR 元宇宙业务机会，三大产业布局已见成效。报告期内，公司聚焦微型光学棱镜模块、车载光电 HUD、越南基地建设三大战略项目，通过重塑组织优化运行模式、以降本增效促推管理体系升级等举措打造内生竞争力，全力保障业务稳健发展和战略快速推进。

水晶光电:关于 2023 年度利润分配预案的公告

经天健会计师事务所审计，2023 年度公司母公司实现的净利润为 4.96 亿元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定提取 10%法定盈余公积金 0.50 亿元，加上年初未分配利润 15.61 亿元，减去 2022 年度分派的现金红利 2.76 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合计可供股东分配的利润为 17.31 亿元。

结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。如以公司现有总股本 13.91 亿股扣除公司回购专户上已回购股份 0.09 亿股后的股本总额 13.82 亿股为基数计算，预计派发现金股利 4.15 亿元（含税），具体金额以实际派发情况为准。

伟测科技:2023 年年度报告

2023 年，公司营业收入为 7.37 亿元，同比增长 0.48%；归属于上市公司股东的净利润

为 1.18 亿元，同比减少 51.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.91 亿元，同比减少 55.06%；经营性现金流净额达 4.63 亿元，同比减少 7.44%；净资产和总资产由所增长，分别达 24.59 亿元及 36.08 亿元，并分别同比增长 3.31% 和 6.57%。

2023 年，全球终端市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，其中消费电子类产品受下游去库存的影响，上半年的测试需求和价格处于低谷。面对十分不利的外部环境，2023 年度公司能够实现营业收入同比增长，主要得益于公司积极调整经营策略，重点发挥自身在高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的突出优势，加快上述领域的测试产能建设、研发投入和客户订单开拓，有效对冲了其他领域需求的下降，最终实现 2023 年的营业收入较 2022 年略有增长。2023 年，公司营业收入较上一年略有增长，但是公司净利润较上年相比下降的主要原因如下：（1）2023 年公司实施股权激励，全年增加股份支付费用预计约 3,464.35 万元，剔除股份支付费用的影响后，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 15,263.98 万元；（2）受行业周期下行的影响，部分测试设备产能利用率下降，以及公司下调了部分测试服务的价格，降低了公司整体盈利能力；（3）IPO 募投项目达产，以及无锡、南京两个测试基地的产能扩张，由于产能利用率还处于爬坡期，导致折旧、摊销、人工成本、能源费用等刚性的固定成本及费用较上年同期相比增加较大；（4）公司加大高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的研发投入，研发费用较上一年增加。

伟测科技:2023 年度利润分配预案的公告

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伟测科技 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.18 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 1.73 亿元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1.13 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 0.36 亿元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.75%；
2. 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

法拉电子:2023 年年度报告

2023 年，公司营业收入为 38.80 亿元，同比增长 1.14%；归属于上市公司股东的净利润为 10.24 亿元，同比增长 1.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9.99 亿元，同比增长 2.47%；经营性现金流继续增长，净额达 11.25 亿元，同比增长 8.05%；净资产和总资产由所增长，分别达 46.99 亿元及 63.06 亿元，并分别同比增长 15.16% 和 11.20%。

2023 年新能源应用市场持续增长。公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、轨道交通、家电等领域中高端客户。通过技术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能力得到进一步提升。

法拉电子:2023 年度利润分配预案的公告

经安永华明会计师事务所审计,公司本报告期实现归属母公司净利润 10.24 亿元人民币,加年初未分配利润 34.37 亿元,减去发放的 2022 年度股利 4.05 亿元,2023 年度未分配利润为 40.56 亿元。

公司 2023 年度利润分配预案为:拟以 2023 年度末股本 2.25 亿股为基数,向全体股东实施每 10 股派送红利 20 元(含税)的分配预案,派发现金总额为人民币 4.50 亿元,占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 43.94%,利润分配后结存未分配利润为 36.06 亿元。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、风险提示

- (1) 半导体制裁加码
- (2) 晶圆厂扩产不及预期
- (3) 研发进展不及预期
- (4) 地缘政治不稳定
- (5) 推荐公司业绩不及预期

■ 电子组介绍

毛正：复旦大学材料学硕士，三年美国半导体上市公司工作经验，曾参与全球领先半导体厂商先进制程项目，五年商品证券投研经验，2018-2020 年就职于国元证券研究所担任电子行业分析师，内核组科技行业专家；2020-2021 年就职于新时代证券研究所担任电子行业首席分析师，iFind 2020 行业最具人气分析师，东方财富 2021 最佳分析师第二名；东方财富 2022 最佳新锐分析师；2021 年加入华鑫证券研究所担任电子行业首席分析师。

高永豪：复旦大学物理学博士，曾先后就职于华为技术有限公司，东方财富证券研究所，2023 年加入华鑫证券研究所。

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4 年投研经验。2023 年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所通信组，2023 年加入华鑫证券研究所。专注于消费电子、卫星互联网、光通信等领域研究。

张璐：香港大学硕士，经济学专业毕业，于 2023 年 12 月加入华鑫证券研究所。

■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	> 20%
2	增持	10% — 20%
3	中性	-10% — 10%
4	卖出	< -10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	> 10%
2	中性	-10% — 10%
3	回避	< -10%

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

■ 免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。